

JPCA 2015 Show

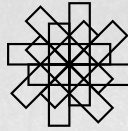
第45回国際電子回路産業展
45th International Electronic Circuits Exhibition

主催：一般社団法人日本電子回路工業会

Sponsored by: JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association

■構成展示会

- 2015プリント配線板技術展
PWB Tech 2015
- 2015半導体パッケージング・部品内蔵技術展
Module Japan 2015
- 2015機器・半導体受託生産システム展
EMS Japan 2015



ラージエレクトロニクスショー2015

共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電子デバイス産業新聞(産案タイムズ社)
Co-Sponsored by:
JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association
Electronic Device Industry News (Sangyo Times, Inc.)

Large Electronics Show 2015

■構成展示会

- 2015プリントエレクトロニクス最適生産システム展
PE PROCESS 2015
- 2015部品・MEMS/デバイス産業総合資材展
Device Engineering 2015
- 2015LED/OLED応用技術展
SS (Solid-State) Lighting 2015



WIRE Japan Show 2015

電線・ケーブル・コネクタ総合技術展

共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電線新聞((株)工業通信)
Electric Wire, Cable, Connector Exhibition

Co-Sponsored by:

JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association
THE ELECTRIC WIRE & CABLE NEWS (KOGYO TSUSHIN CO., LTD.)



2015 マイクロエレクトロニクスショー

第29回 最先端実装技術・パッケージング展

29th ADVANCED ELECTRONICS PACKAGING EXHIBITION

主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP)

Sponsored by: 一般社団法人日本電子回路工業会



JISSO PROTEC 2015

第17回 実装プロセステクノロジー展

17th Jisso Process Technology Exhibition

主催：一般社団法人日本ロボット工業会

Sponsored by: 一般社団法人日本ロボット工業会 (JARA)

ものづくりフェスタ2015

夢をカタチに
次世代アグリ開発支援技術展

結果報告書

2015
6.3(水) - 5(金)

10:00 - 17:00
東京ビッグサイト
www.jpcaashow.com

展示会本部事務局 JPCA 一般社団法人日本電子回路工業会

電子機器トータル ソリューション展示会

のせる つなぐ つくる
そして、ひろげる

ご挨拶

「電子機器トータルソリューション展2015 (JPCA Show / ラージエレクトロニクスショー / マイクロエレクトロニクスショー / WIRE Japan Show / JISSO PROTEC / ものづくりフェスタ)」は、2015年6月3日(水)～5日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催され、出展者数700社、出展小間数1,412小間と盛況裡に無事終了することができました。

これもひとえに、御後援・ご協賛を賜りました経済産業省、在日カナダ大使館・団体をはじめ、御出展いただきました多くの企業の皆様のご支援とご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。

次回開催は、2016年6月1日(水)～3日(金)「電子機器トータルソリューション展2016」を予定しておりますので、御出展・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ここに、今回の結果を取りまとめてご報告申し上げますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

開催 TOPICS ①：展示会結果概要

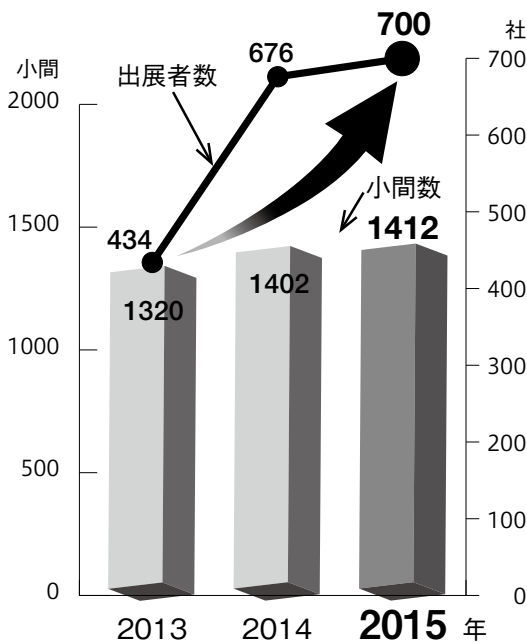
過去最大規模で開催!!



1) 過去3年の開催規模実績 (2013年～2015年)

※2014年からWIRE Japan Show 同時開催

年 度	2013	2014	2015
小 間 数	1,320	1,402	1,412
出 展 者 数	434	676	700
開 催 会 場	東京ビッグサイト	東京ビッグサイト	東京ビッグサイト



() は 昨 年 の 数 字

日程	天候	実登録者数
6月3日(水)	☔ → ☁	12,908名 (12,945名)
6月4日(木)	☀	12,890名 (11,829名)
6月5日(金)	☁ → ☔	13,072名 (12,274名)
合計		38,870名 (37,048名)

セミナー聴講者数 (のべ)

11,265名

国内最大級のセミナー規模として
11,000名以上の動員効果を
生み出しました!

VIP来場者数

5,077名

経営者層等のVIP来場者が
5,000名以上来場し、
商談をされました!

海外来場者数

2,077名

17か国/地域から
2,000名以上の来訪があり、
日本を代表する展示会として
認知されています。

技術者来場

36.9%

来場者の36.9%が、高度な技術者
または設備・工場管理に従事しており、
新製品の開発等新たな活動の
範囲を広げることが可能です。

※ 研究・開発、生産技術・製造技術、設計、
設備・工場管理職種を対象

購買関係者来場

70.5%

来場者の70.5%が購買決定に
関与しており、活発な商談が
行われました。



開催TOPICS②：数々のアワードを展示会場にて実施

第11回 JPCA賞(アワード)

今年で第11回を迎えるJPCA賞(アワード)には、出展者による新製品・新技術紹介「NPIプレゼンテーション」参加企業10社11件より応募を頂いた。『独創性(独自性・オリジナリティ)』、『産業界での発展性・将来性』、『信頼性』、『時世の適合性』を審査基準として、東京理科大学越地特任教授(委員長)、関東学院大学工学部物質生命科学科小岩教授(副委員長)をはじめとする学術界、電子回路業界、専門誌編集者等有識者の方々で構成するJPCA賞(アワード)選考委員会によって厳正な審議を行い、受賞企業には4件の製品・技術が選ばれた。



プリント配線板技術展部門【受賞者】

ナノ銀触媒を用いた無電解銅めっきプロセス NACEプロセス

奥野製薬工業株式会社

当社は銀ナノ粒子を触媒とした無電解銅めっきプロセスとしてNACEプロセスを開発した。特長並びにPd触媒に対する優位性を紹介。

メモリー向け ハロゲンフリー半導体パッケージ基板材料「MEGTRON GX R-1515D/R-1410D」

パナソニック株式会社

近年モバイル機器に搭載されるメモリーPKGの薄型化ニーズが高まっている。当社は独自の低熱膨張樹脂を用い、超薄型CCL&プリプレグを開発し、PKGの薄型+低反りを実現。

車載対応はんだクラック抑制基板材料TD-002

日立化成株式会社

高機能材を使わず、一般材の表層への適用で、はんだクラック対策を可能とすることをコンセプトとし開発した、弾性率が一般FR-4の1/4である低弾性材料TD-002を紹介。

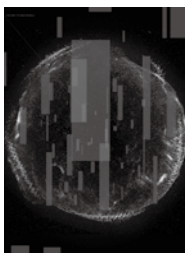
新方式微粒化装置 G-smasherの原理と分散例

リックス株式会社

銀、ニッケルなど、従来の分散機では粒子表面を傷めてしまう柔らかい材料を解砕した例、乾式ジェットミルで難しい金属粒子の粉碎例を示し、新メディアレス湿式分散方式の特長を紹介。

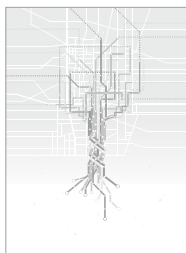
第7回 JPCAデザインアワード

あらゆる電子機器の心臓部として重要な役割を担っている電子回路。その電子回路業界を代表する展示会開催に当たり、美術・デザインを専攻されている学生の皆様の芸術活動支援を目的に、また、電子回路業界の周知を目的に2009年から始まったJPCAデザインアワード(JPCA Design Award)。今年も多数の応募をいただき、JPCAデザインアワード選考委員会において審査の結果、次の作品が決定した。



グランプリ

日本大学大学院
芸術学研究科博士前期課程
張 歆(チョウカン)



優秀賞

日本大学大学院
芸術学研究科博士前期課程
馮 蔚迹(ヒョウエヤ)



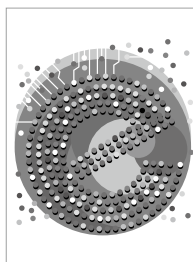
奨励賞

多摩美術大学大学院
美術研究科博士後期課程
柏 大輔



ポスタービジュアル

「電子機器トータルソリューション展」のイメージにふさわしいポスター作りを通して、展示会に対する関心を高めてもらうことを目的に、一般の皆様より多数の応募を頂いた。展示会主催団体において審査の結果、次の作品が決定した。



グランプリ

石山 恵明



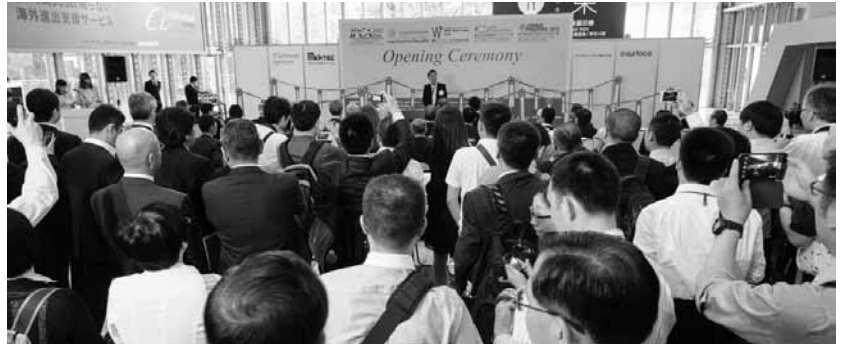
開催TOPICS③：業界のリーダーが集う式典を実施

開会式 電子機器トータルソリューション展 開幕!!

経済産業省、在日カナダ大使館、海外協力団体 (WECC 団体) 及び主催・共催団体 24 名によるテープカットが行われた。



開会宣言 (小林会長)



●日 時：6月3日 (水) 9:30～10:00

●会 場：東京ビッグサイト 北コンコース メインボード前

御来賓	三浦 章豪 アルン・アレクサンダー	経済産業省 在日カナダ大使館	情報通信機器課長 公使 (商務)
開会宣言	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
登壇者	山本 治彦 山下 博樹 岩城 慶太郎 佐藤 英志 曾谷 太 小岩 一郎 土門 孝彰 曾我 信之 永嶋 弘和 青田 広幸 太田 裕之 泉谷 渉 井上 政基 Rex Rozario Wu shou kun KyungHee, KIM Chun-Yin Chen John Mitchell YC Kwok Michael Weinhold VIRAL M BHULANI	一般社団法人日本電子回路工業会 一般社団法人日本電子回路工業会 一般社団法人日本電子回路工業会 一般社団法人日本電子回路工業会 一般社団法人日本電子回路工業会 一般社団法人エレクトロニクス実装学会 一般社団法人エレクトロニクス実装学会 一般社団法人日本ロボット工業会 一般社団法人日本ロボット工業会 一般社団法人日本ロボット工業会 株式会社産業タイムズ社 株式会社工業通信 世界電子回路業界団体協議会 (WECC) 中国印刷電路行業協會 (CPCA) 韓国電子回路産業協會 (KPCA) 台湾電路板協會 (TPCA) 米国電子回路協會 (IPC) 香港線路板協會 (HKPCA) 欧州電子回路協會 (EIPC) 印度プリント回路工業会 (IPCA)	副会長 副会長 副会長 副会長 運営委員会副委員長 副会長 展示委員長 副会長 JISSO PROTEC 運営委員会委員長 JISSO PROTEC 運営委員会委員 JISSO PROTEC 運営委員会委員 代表取締役社長 代表取締役社長 事務総長 Vice-President Chairman Executive Director President and CEO Executive Committee Member Technical Director President

ウェルカムレセプション

出展企業および業界関係者 800名の参加を得て開催。ご来賓として経済産業省富田商務情報政策局長にご挨拶をいただくとともに宮沢経済産業大臣のご祝辞を代読いただいた。

●日 時：6月3日(水) 17:30～19:30

●会 場：東京ビッグサイト レセプションホール

挨拶 / 乾杯登壇	富田 健介	経済産業省	商務情報政策局長
開催挨拶	曾我 信之	一般社団法人日本ロボット工業会	副会長
乾杯発声	泉谷 渉	株式会社産業タイムズ社	代表取締役社長
中締挨拶	小岩 一郎	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	副会長
乾杯登壇	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
	山本 治彦	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	山下 博樹	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	岩城 慶太郎	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	佐藤 英志	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	曾谷 太	一般社団法人日本電子回路工業会	運営委員会副委員長
	土門 孝彰	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	JIEP 展示会事業委員会委員長
	太田 裕之	一般社団法人日本ロボット工業会	JISSO PROTEC 運営委員会委員
	井上 政基	株式会社工業通信	代表取締役社長
	Rex Rozario	世界電子回路業界団体協議会 (WECC)	事務総長
	Wu shou kun	中国印刷電路行業協會 (CPCA)	Vice President
	KyungHee, KIM	韓国電子回路産業協會 (KPCA)	Chairman
	Chun-Yin Chen	台湾電路板協會 (TPCA)	Executive Director
	John Mitchell	米国電子回路協會 (IPC)	President and CEO
	Robin Sun	香港線路板協會 (HKPCA)	Executive Committee Member
	Michael Weinhold	欧州電子回路協會 (EIPC)	Technical Director
	VIRAL M BHULANI	印度プリント回路工業会 (IPCA)	President



開催挨拶
日本ロボット工業会
曾我 信之 副会長



挨拶 / 乾杯登壇
経済産業省
富田 健介 商務情報政策局長



中締挨拶
エレクトロニクス実装学会
小岩 一郎 副会長



乾杯発声
産業タイムズ社
泉谷 渉 代表取締役社長



1 実施概要



(一社) 日本電子回路工業会
会長 小林俊文



展示会運営委員会
委員長 山本治彦



(株) 産業タイムズ社
代表取締役社長 泉谷渉



(株) 工業通信
代表取締役社長 井上政基



(一社) エレクトロニクス実装学会
会長 佐相秀幸



(一社) 日本ロボット工業会
会長 津田純嗣

■ 会 期：2015年6月3日(水)～6月5日(金)

■ 開催時間：10:00～17:00

■ 会 場：東京ビッグサイト 東展示棟・東2～6ホール

■ 名 称：**JPCA Show 2015 第45回国際電子回路産業展**

主 催：一般社団法人日本電子回路工業会 JPCA

構成展示会：2015 プリント配線板技術展 FIELD Tech2015
2015 半導体パッケージング・部品内蔵技術展 Module JAPAN 2015
2015 機器・半導体受託生産システム展 EMS 2015

ラージエレクトロニクスショー2015

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 JPCA

電子デバイス産業新聞((株)産業タイムズ社)

構成展示会：2015 プリントエレクトロニクス最適生産システム展 PE 2015
2015 部品・MEMS/デバイス産業総合資機材展 D Device Engineering 2015
2015 LED/OLED 応用技術展 SS 2015

WIRE Japan Show 2015 電線・ケーブル・コネクタ総合技術展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 JPCA

電線新聞((株)工業通信)

2015マイクロエレクトロニクスショー 第29回 最先端実装技術・パッケージング展

主 催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 ETA

JISSO PROTEC 2015 第17回 実装プロセステクノロジー展

主 催：一般社団法人日本ロボット工業会 JRA

■ 後 援：経済産業省、独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部

■ 特別協力：国立研究開発法人産業技術総合研究所、一般社団法人組込みシステム技術協会、一般社団法人日本銅センター(JCDA)、
超高効率電子回路生産システム研究会(E-ESMAP)、一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)、日本MID協会、
臭素科学・環境フォーラム(BSEF)、SEMI ジャパン、公益財団法人大田区産業振興協会、
公益財団法人神奈川科学技術アカデミー(KAST)高度計測センター、在日カナダ大使館、公益財団法人高知県産業振興センター、神戸市、富山県、
ひょうご・神戸投資サポートセンター、横浜市経済局

■ 海外協力：世界電子回路業界団体協議会 WECC 加盟団体 CPCA-中国印制電路行業協會、EIPC-欧州電子回路協会、HKPCA-香港線路板協會、
IPC-米国電子回路協会、IEI-インド電子回路工業会、KPCA-韓国電子回路産業協會、TPCA-台湾電路板協會

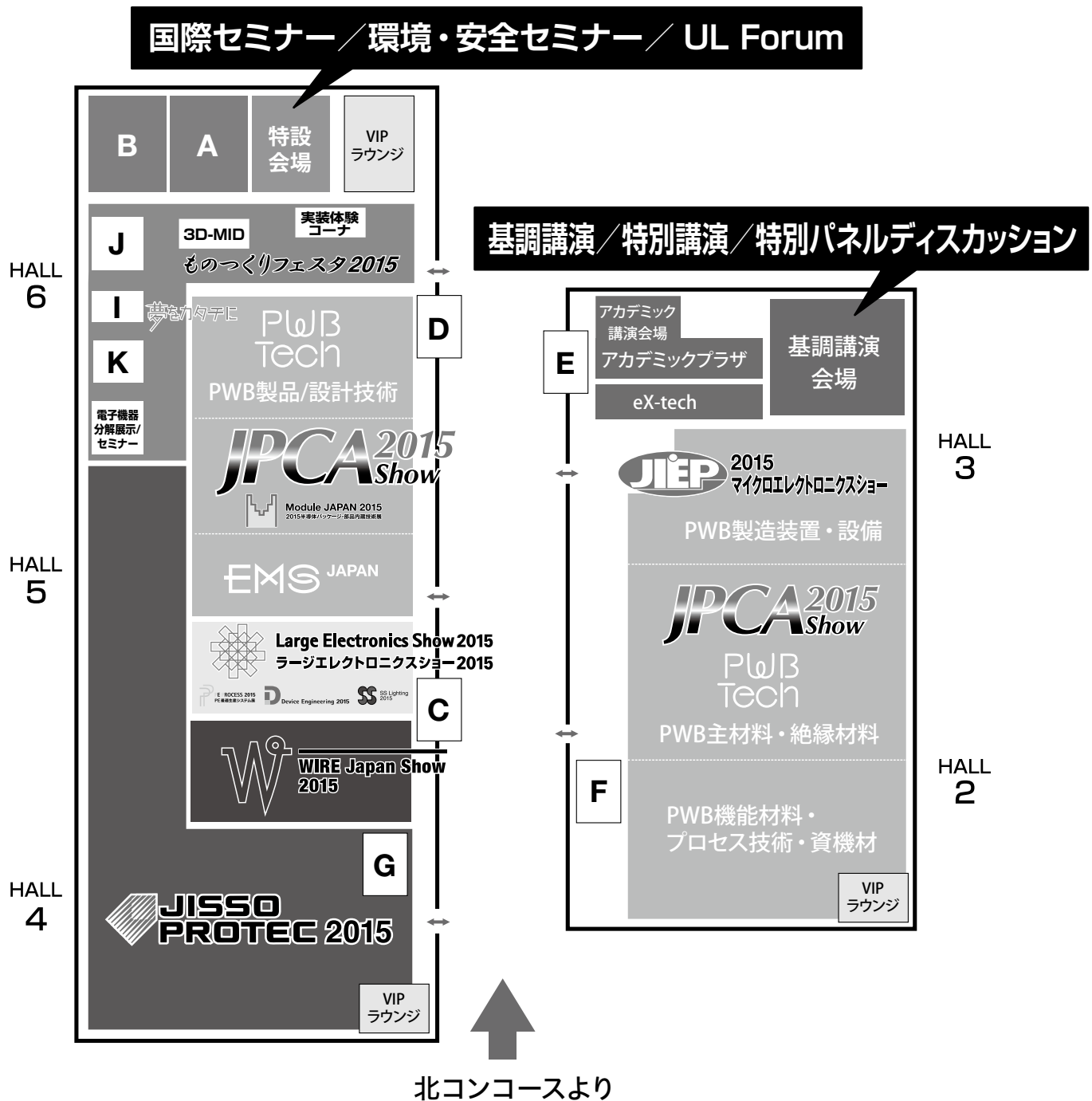
■ 展示会本部事務局：一般社団法人 日本電子回路工業会 JPCA

■ 協 賛：映像情報メディア学会、情報サービス産業協会、情報処理学会、全国鍍金工業組合連合会、電気安全環境研究所、電気学会、電気機能材料工業会、
電気設備学会、電子情報技術産業協会、銅箔工業会、日本医療機器工業会、日本医療機器テクノロジー協会、日本印刷産業連合会、日本オーディオ協会、
日本音響学会、日本化学工業協会、日本火災報知機工業会、日本画像医療システム工業会、日本金型工業会、日本機械工業連合会、
日本金属熱処理工業会、日本計量機器工業連合会、日本検査機器工業会、日本産業機械工業会、日本自動車研究所、日本自動車部品工業会、
日本真空学会、日本精密測定機器工業会、日本電気協会、日本電気計測器工業会、日本電機工業会、日本電気制御機器工業会、日本照明工業会、
日本電線工業会、日本配線システム工業会、日本半導体製造装置協会、日本表面処理機材工業会、日本品質保証機構、日本ファインセラミックス協会、
日本分析化学会、日本分析機器工業会、日本ベアリング工業会、日本遊技関連事業協会、日本溶接協会、光産業技術振興協会、
ビジネス機械・情報システム産業協会、表面技術協会、ファインセラミックスセンター、日本自動車工業会、太陽光発電技術研究組合、
次世代化学材料評価技術研究組合、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所、日本材料科学会、情報通信ネットワーク産業協会、
コンピュータソフトウェア協会

■ 展示会運営事務局：株式会社 ICS コンベンションデザイン



2 会場構成



A会場	JIEP 最先端実装技術シンポジウム
B会場	JIEP 最先端実装技術シンポジウム
C会場	PROTEC セミナー
D会場	NPIプレゼンテーション
E会場	NPIプレゼンテーション
F会場	ぶりんとばんじゅくセミナー/JPCAめっき表面処理セミナー
G会場	半導体・オブ・ザ・イヤー 2015 受賞製品・技術発表/ WIRE Japan Showセミナー/NEDIA 電子デバイス展セミナー/ 駐日大使館・自治体パビリオンセミナー

I会場	PEC Japan 2015/PWBコンサルタント活動/ 電子回路基板ワークショップ
J会場	「夢をカタチに」次世代アプリ開発支援セミナー
K会場	2015年度版プリント配線板技術ロードマップ/ 光電子回路実装標準化セミナー/ JPCA 設計セミナー/セキュリティ真贋認証セミナー
分解展示/セミナー	電子機器分解展示/セミナー
3D-MID	3D-MIDパビリオンセミナー

JPCA Show 2015

株式会社アールエフ
株式会社I.S.T
アイケイ株式会社
株式会社愛工機器製作所
IPC (米国電子回路協会)
IPCA (印度電子回路工業会)
株式会社アイン
鉅橡企業股份有限公司
奥士康科技(香港)有限公司
株式会社アサヒ化学研究所
株式会社アスカエンジニアリング
株式会社アズマ
株式会社厚木ミクロ
株式会社ADEKA
株式会社アドテックエンジニアリング
アドテックジャパン株式会社
荒川化学工業株式会社
アルファエレクトロニクス株式会社
アルメックスPE株式会社
アンデス電気株式会社
EIPC (欧州電子回路協会)
株式会社イーオーテック
eSurface Technology KK
株式会社イースタン
イープロニクス株式会社
株式会社石井表記
株式会社石川工場
石原ケミカル株式会社
伊藤忠マシンテクノス株式会社
伊原電子工業株式会社
イビデン株式会社
インスベック株式会社
WinWay Technology Co.,Ltd
WECC (世界電子回路業界団体協議会)
ウエストウインドエアヘアリング(ジーエスアイ・グループ)
衛司特科技股份有限公司
上村工業株式会社
永旺株式会社
HKPCA (香港線路板協会)
株式会社エイト工業
株式会社AJ
ACE Electronics Co., Ltd
エーティージー ルーサー アンド メルツァー
有限会社エービーシー
EXPRESS ELECTRONICS LIMITED
株式会社エス・エム・シー
NTW Inc. 株式会社
エビナ電化工業株式会社
株式会社FPCコネク
株式会社エム・シー・ケー
LPKF Laser&Electronics 株式会社
株式会社オーク製作所
株式会社オーケープリント
株式会社オーディオテクニカ
大船企業日本株式会社
オカダジーエージェイ株式会社
オキツモ株式会社
沖電線株式会社
奥野製薬工業株式会社
オルガン針株式会社
ガーディアンジャパン株式会社
皆見電子工業株式会社
花王株式会社
株式会社化学工業日報
嘉世通企業有限公司
勝宏科技(専州)株式会社
株式会社カネカ
株式会社カミツ
カワムラ精機株式会社
関西電資株式会社
広東生益科技股份有限公司
GigaVis CO., LTD.
北川精機株式会社
協栄プリント技研株式会社
株式会社京写
京セラサーキットソリューションズ株式会社
Kingboard Laminates Holdings Limited
クアドセプト株式会社
Guangzhou City Changcheng Titanium Metal Co., Ltd.
邦田工業株式会社
倉敷紡績株式会社
株式会社グローウィル

KPCA (韓国電子回路産業協会)
ケセル株式会社
株式会社ケミロン
株式会社ケムテック・ジャパン
ケンマージャパン株式会社
KOA株式会社
互応化学工業株式会社
GOAL SEARCHERS CO., LTD ZHUHAI
国際技術開発株式会社
株式会社サーマプレジジョン
サイバネットシステム株式会社
栄電子工業株式会社
相模ビーシーアイ株式会社
相模ビーシーアイ株式会社
株式会社サクラクレバス
株式会社サトーセン
山栄化学株式会社
三晃技研工業株式会社
三次元半導体研究センター
株式会社サンシン
株式会社サンヨー工業
三立興産株式会社
サンワ化学工業株式会社
株式会社三和研究所
三和電子機器株式会社
三和電子サーキット株式会社
三和ニューテック株式会社
シエムケイプロダクツ
CPCA (中国印制電路行業協会)
JX日鉱日石金属株式会社
株式会社JCU
JPCA (日本電子回路工業会)
J-RAS株式会社
Zhejiang HuaZheng New material Co., Ltd
JADASON Enterprises Limited
SHENZHEN JINZHOU PRECISION TECHNOLOGY CORP.
Shenzhen JMTH Electronics Technology Co., Ltd
Shenzhen Newccess Industrial CO., LTD.
Shezhen PCB Door Electronic Commerce Co., Ltd.
SHENZHEN SUNTAK CIRCUIT TECHNOLOGY CO., LTD
株式会社シグナス
四国化成工業株式会社
株式会社島津製作所
ジャプロ工業株式会社
Shanghai Nanya Copper Clad Laminate Co., Ltd
臭素科学・環境フォーラム日本 (BSEF)
Zuhai Kingsun Electronic and Technology CO., LTD
ZHUHAI KINGROAD ELECTRONIC CO., LTD.
シュモール マシン
ショーデータエレクトロニクス株式会社
シライ電子工業株式会社
株式会社伸光製作所
Suzhou Chengbangdai Material Technology Co., Ltd
株式会社SCREENグラフィックアンドプレジジョンソリューションズ
ステイ電子機器株式会社
ステラ株式会社
株式会社ステラ・コーポレーション
住友重機工業株式会社
株式会社清和光学製作所
積水化学工業株式会社
CEDAL EQUIPMENT SRL
株式会社セリアコーポレーション
双日プラネット株式会社
株式会社ソフミックス
ソマル株式会社
高台資訊股份有限公司
大英エレクトロニクス株式会社
大道産業株式会社
ダイナロン株式会社
大日工業株式会社
太陽インキ製造株式会社
太洋工業株式会社
株式会社ダイワ
株式会社ダイワ工業
台湾港建股份有限公司
Tae Sung Co., Ltd.
株式会社タカハタ電子
タキロン株式会社
株式会社タケウチ
田代電化工業株式会社
タツタ電線株式会社
株式会社棚澤 八光社
株式会社タムラ製作所
株式会社ちの技研

China Circuit Technology (Shantou) Corporation
チューリップ株式会社
長興材料工業株式会社
株式会社角田プラン製作所
TR (HK) COMPANY LIMITED
DMカードジャパン株式会社
ティーシーティー・ジャパン株式会社
TPCA (台湾電路板協会)
デュボン株式会社
株式会社デンソー
株式会社電波新聞社
唐威科技股份有限公司
東海神栄電子工業株式会社
東海東洋アルミ販売株式会社
東京応化工業株式会社
東京化工機株式会社
東京パーツ工業株式会社
東京マシン・アンド・ツール株式会社
東光技研工業株式会社
株式会社東光高岳
東芝ITコントロールシステム株式会社
東朋テクノロジー株式会社
東洋アルミニウム株式会社
東レ・デュボン株式会社
トヨケム株式会社
株式会社トッポポイント・ジャパン
中島化学産業株式会社
鍋屋バイテック会社
ナミックス株式会社
株式会社ニコンテック
株式会社ニソール
ニッカン工業株式会社
日刊工業新聞社
ニッコー・マテリアルズ株式会社
ニッタ株式会社
日鉄住金マイクrometal株式会社
株式会社日放電子
NIPPON (BOLUO) ELECTRONICS.,LTD.
株式会社二宮システム
日本アグファマテリアルズ株式会社
日本エバレット・チャールズ株式会社
日本オルボテック株式会社
日本化学産業株式会社
日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
株式会社日本工業新聞社
日本高純度化学株式会社
日本シエムケイ株式会社
日本電気硝子株式会社
日本電産リード株式会社
一般社団法人日本電子回路工業会
日本ポリテック株式会社
日本マクダーミッド株式会社
日本ミクロン株式会社
日本メクロン株式会社
株式会社野田スクリーン
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
Park Electrochemical Corp.
Baoji Special Steel Titanium Industry Co., Ltd.
伯東株式会社
八光電子工業株式会社
パナソニック株式会社
有限会社ハラサクス
バンコク・インダストリアル・ラミネート株式会社
PAN-TEC CORPORATION LIMITED
ピアメカニクス株式会社
株式会社ピーバンドットコム
株式会社ピームセン
日置電機株式会社
順浩科技股份有限公司
日立化成株式会社
日立化成商事株式会社
株式会社日立ハイテクサイエンス
株式会社平山ファインテクノ
ヒロセ電機株式会社
株式会社ファーネス
株式会社ファインテック
和仁貿易(ファインボウエキ)
株式会社フィッシャー・インストルメンツ
公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団
福田金属箔工業株式会社
福田交易株式会社
株式会社フジ機工
株式会社フジクラ
富士通インターコネクトテクノロジーズ株式会社

富士プリント工業株式会社
 ブラメックス株式会社
 株式会社ブリマックス
 株式会社プリント回路ジャーナル
 株式会社ブルックスジャパン
 株式会社フレックス・サービス
 文坦自動化有限公司
 株式会社ベアック
 マイクロクラフト株式会社
 マイクロテック・ラボラトリーズ
 株式会社マイクログロセス
 松定プレジジョン株式会社
 松田産業株式会社
 株式会社九源鉄工所
 三菱ガス化学株式会社
 三菱電機株式会社
 三福工業株式会社
 ミノインターナショナル株式会社
 株式会社ミノグループ
 株式会社村上電子工学
 株式会社ムラキ
 株式会社ムラタ
 株式会社村田製作所
 名東電産株式会社
 めっき委員会
 ムック株式会社
 メルテックス株式会社
 メレスグリオ株式会社
 株式会社モトロニクス
 森川産業株式会社
 森村商事株式会社
 株式会社安永
 株式会社ヤチヨ・コーポレーション
 山下マテリアル株式会社
 ヤマハファインテック株式会社
 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
 UCAMCO
 ユニオンツール株式会社
 ユニクラフト株式会社
 ユニバーサルP.C.B設備有限公司
 米沢ダイヤエレクトロニクス株式会社
 株式会社ライズエレクトロニクス
 株式会社ラットコーポレーション
 連結機械股份有限公司
 利昌工業株式会社
 RITAエレクトロニクス株式会社
 RITAエレクトロプロダクツ株式会社
 リックス株式会社
 株式会社リョウワ
 株式会社レヨン工業
 ローム・アンド・ハース電子材料株式会社(ダウ・ケミカルグループ)
 碌々産業株式会社
 株式会社ロゼッタ

ラージエレクトロニクスショー2015

アサダメッシュ株式会社
 Asia Pacific Microsystems, Inc.
 株式会社インコム
 ウシオ電機株式会社
 株式会社SPIエンジニアリング
 加美電子工業株式会社
 キヤノントッキ株式会社
 ケイエスリンクス株式会社
 株式会社産業タイムズ社
 昭光通商株式会社
 昭和電工株式会社
 株式会社SCREENホールディングス
 株式会社テクニスコ
 日刊工業新聞社
 NovaCentrix
 豊元化学株式会社

2015マイクロエレクトロニクスショー

味の素ファインテクノ株式会社
 アビックヤマダ株式会社
 アルテック株式会社
 株式会社 Wave Technology
 株式会社ウェル テストウェア営業部
 株式会社ウェル プラズマ装置営業部
 株式会社SIJテクノロジー
 エスベック株式会社
 愛媛大学 樋上・王・高橋研究室
 一般社団法人エレクトロニクス実装学会
 株式会社エンプラス半導体機器
 大阪府立大学 工学研究科 応用化学分野
 株式会社グリーンケム
 株式会社岡本工作機械製作所
 神奈川工科大学 小室研究室

関東学院大学 小岩研究室/
 沖エンジニアリング株式会社
 関東学院大学 小岩研究室/電子科学株式会社
 関東学院大学 小岩研究室/フォトテクニカ株式会社
 関東学院大学 材料・表面工学研究所
 九州大学大学院システム情報科学研究所
 九州大学日本エレクトロニクス技術連携センター
 九州大学 ナノ・マイクロ医学工学研究室
 群馬大学 先端科学研究指導者育成ユニット
 神戸大学 木村研究室
 シーマ電子株式会社
 芝浦工業大学 エネルギー物性研究室
 フレキシブル実装工学研究センター
 Shimada Appli 合同会社
 信州大学 先端磁気デバイス(佐藤・曾根原)研究室
 スピンデバイステクノロジーセンター
 信州大学 先端磁気デバイス(佐藤・曾根原)研究室/
 長野工業高等専門学校 中山研究室
 太陽社電気株式会社
 電子実装工学研究所
 東京工芸大学 越地研究室
 東京大学大学院工学系研究科 実装工学分野研究室
 東京大学大学院
 染谷「生体調和エレクトロニクス」プロジェクト
 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
 東京理科大学 板垣・四反田研究室
 同志社大学 生産システムデザイン研究室(1)/
 龍谷大学 理工学部
 同志社大学 生産システムデザイン研究室(2)/
 龍谷大学 理工学部
 東北マイクロテック株式会社/
 東北大学 未来科学技術共同研究センター 小柳研究室
 長野工業高等専門学校 中山研究室/
 信州大学 先端磁気デバイス(佐藤・曾根原)研究室
 株式会社ニッセイ
 日本大学 内木場・齊藤研究室(1)
 日本大学 内木場・齊藤研究室(2)
 日本大学 内木場・齊藤研究室(3)
 日本パーカラライジング株式会社/
 関東学院大学 小岩研究室
 ハニー化成株式会社
 株式会社日立パワーソリューションズ
 兵庫県立大学 表面エネルギー化学研究グループ
 福岡県工業技術センター 化学繊維研究所
 福岡大学 半導体実装研究所 友景研究室
 富士通クオリティ・ラボ株式会社
 株式会社プラズマイオンアシスト
 Hojeon able.lnc
 株式会社マニファクチャリングソリューション
 明星大学 連携研究センター/
 株式会社 MIRAI
 名東電産株式会社
 山梨大学 近藤・渡邊研究室
 横浜国立大学大学院工学府/
 横浜国立大学大学院工学研究院
 早稲田大学 巽研究室

JISSO PROTEC 2015

アズワン株式会社
 アム工業株式会社
 アルファデザイン株式会社
 株式会社いけうち
 エイテックテクトロン株式会社
 株式会社エーアイテック
 エーエスエム・アッセンブリー・システム シンガポール
 エーエスエム・アッセンブリー・テクノロジー株式会社
 NTN株式会社
 大塚精工株式会社
 株式会社沖電気コミュニケーションシステムズ
 奥原電気株式会社
 オリジン電気株式会社
 化研テック株式会社
 川崎重工業株式会社
 Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社
 株式会社コアーズ
 株式会社コーヨントテクノロジー
 株式会社サヤカ
 山陽精工株式会社
 CKD株式会社
 ジャパンコーン株式会社
 株式会社ジャパンユニックス
 JUKI株式会社
 株式会社シニアバックス
 セイテック株式会社
 千住金属工業株式会社
 太平洋電機株式会社
 タカヤ株式会社
 竹内精工株式会社
 株式会社タムラ製作所

テクネック・ジャパン・リミテッド
 テクノアルファ株式会社
 天竜精機株式会社
 長瀬産業株式会社
 ナガセテクノエンジニアリング
 株式会社日経BP
 株式会社日本スベリア社
 日本トムソン株式会社
 日本ミルテック株式会社
 一般社団法人日本ロボット工業会
 ハイウイン株式会社
 パスコン株式会社
 Pac Tech GmbH
 白光株式会社
 パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社
 ビーエス株式会社
 富士機械製造株式会社
 マイクロニックテクノロジー株式会社
 マイクロモジュールテクノロジー株式会社
 株式会社マルコム
 丸文株式会社
 三木ブリー株式会社
 株式会社妙徳
 武蔵エンジニアリング株式会社
 ヤマハ発動機株式会社
 ヤマハ発動機株式会社 IM事業部 アイバルス営業グループ
 ユニテック株式会社
 ユニテンプジャパン株式会社

WIRE Japan Show 2015

ウェストラル
 エヌビーエス株式会社
 オートメ新聞株式会社
 木島通信電線株式会社
 キヤノン電子株式会社
 株式会社ケー・フラッシュ商会
 株式会社工業通信
 コーンズドッドウェル コーディング株式会社
 株式会社ササキ
 泉州電業株式会社
 日本マルコ株式会社

ものづくりフェスタ2015

アストロデザイン株式会社
 地方独立行政法人岩手県工業技術センター
 エビナ電化工業株式会社
 エポックサイエンス株式会社
 LPKF Laser&Electronics 株式会社
 エンズインガージャパン株式会社
 公益財団法人 大田区産業振興協会
 沖プリンテッドサーキット株式会社
 公益財団法人神奈川科学技術アカデミー(KAST) 高度計測センター
 一般社団法人 組込みシステム技術協会(JASA)
 高知県/公益財団法人高知県産業振興センター
 神戸市
 在日カナダ大使館
 三共化成株式会社
 国立研究開発法人産業技術総合研究所
 三共精密金型株式会社
 株式会社ジャパンユニックス
 臭素科学・環境フォーラム日本(BSEF)
 株式会社Sohwa&Sophia Technologies
 株式会社図研
 株式会社ストラテジー
 セストロンジャパン株式会社
 SEMIジャパン
 株式会社ソフトサービス
 大英エレクトロニクス株式会社
 株式会社DMMM.com
 株式会社高田工業所
 株式会社テレパシージャパン
 東レ・デュボン株式会社
 富山県
 日本マクダーミッド株式会社
 日本MID協会
 NEDIA(一般社団法人日本電子デバイス産業協会)
 ハーティング株式会社
 パナソニック株式会社
 ひょうご・神戸投資サポートセンター
 富士機械製造株式会社
 株式会社メルシー
 MOLEX JAPAN LLC
 横浜市 経済局
 ローム・アンド・ハース電子材料株式会社(ダウ・ケミカルグループ)

4 基調講演・特別講演・特別パネルディスカッション

- 日 時：6月3日(水)～5日(金)
- 会 場：東3ホール 基調講演会場
- 聴 講 料：会員10,000円/セッション 非会員20,000円/セッション(全て税込)
- 聴 講 者 数：全11セッション 2,692名(前回実績全6セッション 2,536名)
- テ ー マ：急上昇!日本のものづくり「自動車」「ロボット・ウェアラブル」「情報通信・センサ」「医療・ヘルスケア」

6月3日(水)	基調講演 ロボット 最新のロボット動向と電子業界への提案 橋本康彦 川崎重工(株) 執行役員	基調講演 3Dプリンティング・MID MID技術の現状 新野俊樹 東京大学生産技術研究所 教授
	基調講演 ウェアラブル/基板の新展開 感じる機能素材「hitoe」が導く未来 森内一成 日本電信電話(株) 研究企画部門 チーフプロデューサー	

6月4日(木)	基調講演 自動車 自動運転の将来展望 遠藤徳和 トヨタ自動車(株) BR高度知能化運転支援開発室 主査	特別講演 世界のものづくりをリードする日本企業 強いモノづくりをめざして 石川達也 トヨタ自動車(株) 車両系生産技術領域 領域長/常務理事
	基調講演 電子デバイス(一般電子部品の革新が拡げる基板の新世界) 先端コンデンサ、部品内蔵基板、次世代センサの動向 泉谷渉 (株)産業タイムズ社 代表取締役社長	
	特別パネルディスカッション 4K/8Kを支える撮影機材(スチル・ムービー・レンズ)の最新動向 コーディネータ: 後藤哲朗 展示会企画委員会 委員/(株)ニコン フェロー 映像事業部 後藤研究室長 座長: 津村明宏 電子デバイス産業新聞 編集局長 パネリスト: 平沢方秀 キヤノン(株) ICP第四開発センター所長 大曽根康裕 (株)シグマ 商品企画部 部長 安藤稔 (株)タムロン 光学開発本部・本部長 山根洋介 パナソニック(株) AVCネットワークス社 イメージングネットワーク事業部 イメージング開発センター 所長 山本哲也 (株)ニコン 執行役員 映像事業部 開発統括部長	

6月5日(金)	基調講演 IoT・ビッグデータ IoT・ビッグデータが拓くビジネスと社会 柴原節男 (株)日立製作所 情報・通信システム社 CSO	基調講演 ウェアラブル/ヘルスケア端末 次世代フレキシブルデバイスとヘルスケア 染谷隆夫 東京大学 工学系研究科 教授
	基調講演 IoTと次世代センサ トリリオン・センサ最新動向 ～日本の課題～ 神永晋 SPPテクノロジーズ(株) エグゼクティブシニアアドバイザー	基調講演 ウェアラブル/ヘルスケア端末 スマートグラスMOVERIO BT200製品概要と使用シーンのご紹介 馬場宏行 セイコーエプソン(株) HMD事業推進部

石川達也 トヨタ自動車(株) 車両系生産技術領域 領域長/常務理事



5 国際セミナー／環境・安全セミナー／UL Forum／JIEP最先端実装技術シンポジウム

国際セミナー ー我が国 PCB産業の新常態に向けて

同時通訳有

●日 時：6月3日(水)、4日(木)

●会 場：東6ホール 特設会場

●聴講料：事前登録5,000円/セッション 当日登録7,000円/セッション(全て税込)

●聴講者数：383名

6月3日(水)		
国際セミナー Session I		
13:00~14:00	Stretchable electronics and electronic textile, new frontiers for PCB technology Mr. Johan De Baets Group manager, Center for Microsystems Technology, Imec	14:00~15:00 How will PB Manufacturing Change in a Digital Age Mr. Hikmat Chammas Engineer Fellow, Advanced Manufacturing Engineering, Honeywell Aerospace
		15:00~16:00 Robert Bosch perspectives on PCB technologies/PCB procurement Mr. Joerg D. Schaefer Head of PCB Technology Development HK, Robert Bosch
6月4日(木)		
国際セミナー Session II		
10:30~11:00	インダストリー4.0の時代、方正 - Founderが考えるPCBの未来とは? Mr. Hu Yongshuan President, Zhuhai Founder PCB Development Co., Ltd.	11:00~11:30 “興森快捷” - Fastprint成長の歩み Mr. Qiu Xingya Chairperson, Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co., Ltd.
		11:30~12:00 イノベーションドリブン、スマートなモデル転換 - “新常態”ニューノーマル時代の中国PCB産業発展の道 Mr. You Lei Chairperson, CPCA (中国印制电路板行业协会)
6月5日(金)		
国際セミナー Session III		
14:00~15:00	Strategies for the printed circuit industry in Europe Dr. Udo Betchtloff Chairman of the Managing Board, KSG Leiterplatten GmbH	15:00~16:00 世界のPCB, 日本のPCB 日本語講演・英語同時通訳なし 中原 捷雄 President, NT Information, Ltd.

各Session後、各講師との名刺交換セッション(Chat Time)を行った。

環境・安全セミナー／UL Forum

同時通訳有

●日 時：6月5日(金)

●会 場：東6ホール 特設会場

●聴講者数：131名

6月5日(金)	
環境・安全セミナー	
10:30~11:30	国際機関における化学物質規制の歴史と国の対応 北野 大 淑徳大学 人文学部 表現学科 東京図書館長 教授
11:30~12:30	An Examination of the Prospective Benefits of Manufacturing Electronic Assemblies Without Solder Mr. Joseph Fjelstad Founder, Verdant Electronics
環境・安全セミナー／UL Forum	
13:00~14:00	UL's newservices for PWB Mr. Irving Lee Global Program Manager, Consumer Technology, UL AG, Taiwan Branch
14:00~15:00	Latest situation of UL 746/796 standards Ms. Crystal Vanderpan Principal Engineer, PV Materials and Printed Circuit Technologies, Product Safety, UL LLC

JIEP最先端実装技術シンポジウム

●日 時：6月3日(水)~5日(金)

●会 場：東6ホール A・B会場

●聴講料：有料

●聴講者数：549名(前回実績：455名)

6月3日(水)			
A会場		B会場	
3A1 10:40-12:30 座長:宝蔵寺 裕之	3A2 13:35-16:20 座長:三宅 敏広	3B1 10:40-12:30 座長:土門 孝彰	3B2 13:35-16:20 座長:八甫谷 明彦
パワーエレクトロニクスの将来と応用	車載システムの進化と実装技術革新の方向性	IoT/M2Mと求められる最新技術	食・健康・生活への近未来技術
最新パワー半導体デバイスの現状とこれから 岩室 憲幸 筑波大学 高効率変換回路を実現する最新のパワー半導体デバイス 五十嵐 征輝 富士電機株	先進自動車エレクトロニクスの開発動向 服部 佳智 株豊田中央研究所 車載パワーデバイスの動向と課題 神谷 有弘 株デンソー Si/PI/EMIシミュレーション技術と車載用電子設計への適用 浅井 秀樹 静岡大学	IoTと農業用電子部品 島村 博 株イーラポ・エクスベリエンズ トリオン・センサ社会に向けたMEMSセンサ製造技術 金尾 寛人 SPPテクノロジー株	東芝の植物工場事業 松元 範昭 株東芝 音声から病気の早期発見を可能にする技術 音声画像分析 光吉 俊二 東京大学 繊維基材材のナノマイクロ加工と製織を利用した布基板技術 伊藤 寿浩 東京大学
6月4日(木)			
A会場		B会場	
4A1 9:45-12:30 座長:田畑 晴夫	4A2 13:35-16:20 座長:内木場 文男	4B1 9:45-12:30 座長:伊藤 寿浩	4B2 13:35-16:20 座長:小日向 茂
次世代ワイドギャップパワーデバイスへの期待	ロボットと人間社会との関わり	ヘルスケア用新デバイスの現状と将来	次世代実装材料の革新技術
次世代パワーデバイスダイヤモンド接合型FETの可能性と課題 波多野 睦子 東京工業大学 SiCパワー素子の現状と課題 山口 浩 産業技術総合研究所 ノーマリアフGaNトランジスタのパワーエレクトロニクス応用 高橋 理 パナソニック株	災害救助用レスキューロボットの現状と課題 羽多野 正俊 日本大学 アシストスーツの最新技術 浅野 克久 アクティブリンク株 トリオンセンサ社会に向けたMEMSセンサ及びセンサネットワークの動向 今本 浩史 (一財)マイクロマシンセンター	マイクロ・ナノ医療デバイスの実装技術 三木 則尚 慶應義塾大学 マイクロシステムを用いた医療・ヘルスケア機器の開発 芳賀 洋一 東北大学 クラウド時代のヘルスケアモニタリングシステム構築と応用 板生 清 NPO法人ウェアラブル環境情報ネット推進機構	半導体実装のための無機異方性導電材料の開発 黒岡 俊次 富士フィルム株 熱抵抗低減に向けた熱伝導性フィルム材料の開発 高杉 寛史 ナミックス株 2.5Dインターポーザ用微細配線形成技術と課題点 藤本 大輔 日立化成株
6月5日(金)			
A会場		B会場	
5A1 9:45-12:30 座長:土門 孝彰	5A2 13:35-16:20 座長:田畑 晴夫	5B1 9:45-12:30 座長:和嶋 元世	5B2 13:35-16:20 座長:小岩 一郎
ウェアラブル機器が拓く次世代社会の展望	今後どうなる2.1D、2.5D、3D実装	次世代モバイル機器対応実装技術	進化を続ける部品内蔵基板技術とその戦略
人体通信によるウェアラブル・コミュニケーション 加藤 康男 青山学院大学 エプソンのウェアラブル機器の実装技術 岡ヶ部 明 セイコーエプソン株 M2Mの急伸で電子部品が変わる! 一センサ、モジュールの動向を探る一 梶田 栄 NPO法人サーキットネットワーク	2.1D、2.5D、3D実装の最新動向 本多 進 NPO法人サーキットネットワーク HMC (Hybrid Memory Cube) and 3D Integration 朝倉 善智 マイクロンジャパン株 IoTを支えるコンピューティングパッケージ 市川 公也 インテル株	狭間部品実装技術によるキャパシタ内蔵インターポーザ 菊地 克弥 産業技術総合研究所 ビルドアップ工法適用のためのデスマス工程対応無電解めっき向けポリイミドフィルム 横沢 伊裕 宇部興産株 2.1D、2.5D用高密度パッケージ 清水 規良 新光電気工業株	ジェイデバイスのPLP技術 勝又 章夫 株ジェイデバイス Panel Level Embedded Substrate Technology for High Performance Application Yu-Hua Chen UNIMICRON 部品内蔵配線板 EOMIN™ の最新動向 宮崎 政志 太陽誘電株

6 出展者セミナー

1) NPIプレゼンテーション (出展者製品技術セミナー)

- 日 時：6月3日(水)～5日(金)
- 会 場：東6ホール D会場/東3ホール E会場
- 聴 講 料：無料
- 聴講者数：1,408名(前回実績：2,536名)

<p>●発表出展会社 (50音順)</p> <p>アトテックジャパン(株)/アコム工業(株)/荒川化学工業(株)/石原ケミカル(株)/上村工業(株)/ (株)オーク製作所/(株)沖電気コミュニケーションシステムズ/奥野製薬工業(株)/ ガーディアンジャパン(株)/クアッドセプト(株)/(株)サクラクレパス/(株)JCU/ (株)島津製作所/(株)SCREENグラフィックアンドプレジジョンソリューションズ/ 千住金属工業(株)/ダイナトロン(株)/(株)タムラ製作所/テクノアルファ(株)/天竜精機(株)/ (株)東光高岳/トーヨーケム(株)/NovaCentrix/鍋屋バイテック会社/(株)ニソール/ 日本オルボテック(株)/日本ケイデンス・デザイン・システムズ社/ 日本シイエムケイ(株)/日本マクダーミッド(株)/パナソニック(株)/(株)ビームセンス/ 日立化成(株)/(株)日立ハイテクサイエンス/(公財)福岡県産業・科学技術振興財団/ (株)フジ精工/富士通インターコネクテクトテクノロジーズ(株)/(株)マイクロプロセス/ 松田産業(株)/(株)村田製作所/メルテックス(株)/(株)安永/ ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株)/ユニオンツール(株)/リックス(株)</p>
--

2) アカデミックプラザ

- 日 時：6月3日(水)～5日(金)
- 会 場：東3ホール アカデミックプラザ会場
- 聴 講 料：無料
- 聴講者数：464名(前回実績：734名)

<p>●アカデミックプラザ参加大学・研究機関等一覧 (50音順)</p> <p>NHK放送技術研究所/大阪府立大学/沖エンジニアリング(株)/神奈川工科大学/ 関東学院大学/九州大学/(株)グリーンケム/群馬工業高等専門学校/群馬大学/ 神戸大学/芝浦工業大学/信州大学/スピンドバイステクノロジーセンター/ 電子科学(株)/東京工芸大学/東京大学/(地独)東京都立産業技術研究センター/ 同志社大学/長野工業高等専門学校/日本大学/日本パーカライジング(株)/ フォトテクニカ(株)/福岡県工業技術センター/福岡大学/山梨大学/ 横浜国立大学大学院/龍谷大学/早稲田大学大学院</p>
--

3) PROTECセミナー

- 日 時：6月3日(水)～5日(金)
- 会 場：東5ホール C会場
- 聴 講 料：無料
- 聴講者数：881名(前回実績：523名)

特別講演	
6月3日(水)	
ウェアラブルからドローン、サイボーグへ	神戸大学 大学院 工学研究科 教授 塚本 昌彦
6月4日(木)	
電子機器の実装技術動向	エスベック(株) テストコンサルティング本部 主席技師 高橋 邦明
6月5日(金)	
常温接合が拓く新しい実装の世界	東京大学 大学院工学系研究科 教授 須賀 唯知

<p>●発表出展会社 (50音順)</p> <p>ASM Assembly Systems/パナソニック ファクトリーソリューションズ(株)/ 富士機械製造(株)/武蔵エンジニアリング(株)/ヤマハ発動機(株)</p>

4) 3D-MIDセミナー

- 日 時：6月3日(水)～5日(金)
- 会 場：東6ホール 3D-MIDパビリオン内
- 聴 講 料：無料
- 聴講者数：474名(前回実績：509名)

6月3日(水)	
MIDの技術動向および日本MID協会のご紹介	日本MID協会
LPKF LDS®の最新動向とアプリケーション	LPKF Laser & Electronics (株)
モジュール型汎用自動組立装置 SmartFABによる3D-MID実装	富士機械製造(株)
LDSプロセスにおけるMIDめっき技術 ～ファインピッチと環境対応への取り組み～	日本マクダーミッド(株)
Molex MID / Antenna	Molex Global Commercial Product Division
3D-MID設計用CAD NEXTRAのご紹介	FlowCAD EDA-Software Vertriebs GmbH
SKWプロセスによる3D-MID	三共化成(株)
超短パルスレーザを用いたMID工法	(地独)岩手県工業技術センター
6月4日(木)	
MIDの技術動向および日本MID協会のご紹介	日本MID協会
SKWプロセスによる3D-MID	三共化成(株)
超短パルスレーザを用いたMID工法	(地独)岩手県工業技術センター
LDSプロセスにおけるMIDめっき技術 ～ファインピッチと環境対応への取り組み～	日本マクダーミッド(株)
自動車/医療アプリケーションにおける 3D-MIDセンサ用パッケージング	HARTING AG (スイス)
LPKF LDS®の最新動向とアプリケーション	LPKF Laser & Electronics (株)
3D-MID設計用CAD NEXTRAのご紹介	FlowCAD EDA-Software Vertriebs GmbH
Molex MID / Antenna	Molex Global Commercial Product Division
6月5日(金)	
MIDの技術動向および日本MID協会のご紹介	日本MID協会
パナソニック MIDソリューション	パナソニック(株)
SKWプロセスによる3D-MID	三共化成(株)
超短パルスレーザを用いたMID工法	(地独)岩手県工業技術センター
3D-MID設計用CAD NEXTRAのご紹介	FlowCAD EDA-Software Vertriebs GmbH
3D-MID対応高機能プラスチックのご紹介	エンズインガー・ジャパン(株)
LDSプロセスにおけるMIDめっき技術 ～ファインピッチと環境対応への取り組み～	日本マクダーミッド(株)
LPKF LDS®の最新動向とアプリケーション	LPKF Laser & Electronics (株)

7 標準化戦略セミナー

1) 第4回プリントエレクトロニクスコンベンション (PEC Japan 2015)

- 日 時：6月3日(水)
- 会 場：東6ホールI会場
- 聴講者数：597名(前回実績：650名)

基調講演 プリントエレクトロニクスは実用化するのか?	牛島 洋史 産業技術総合研究所 フレキシブルエレクトロニクス研究センター 副研究センター長
大面積エレクトロニクスと先進スクリーン印刷技術	佐野 康 (株)エスピーソリューション 代表取締役
実用的高精細回路印刷の現状と次世代PE製品	田中 稔彦 東洋インキSCホールディングス(株) グループテクノロジーセンター 事業開発部長
快適性評価技術を活用した商品開発	石丸 園子 東洋紡(株) 総合研究所 コーポレート研究所 快適性工学センター 部長
3Dインクジェットプリンタによる三次元回路実装技術	藤田 政利 富士機械製造(株) 開発センター 技術開発部 第2技術課
3Dインクジェットプリンタによる三次元回路実装用デザインソフトウェア	山本 晃司 (株)ワイ・ディ・シー DCM事業本部 戦略企画室 室長

2) PWBコンサルタント活動

- 日 時：6月4日(木)
- 会 場：東6ホールI会場
- 聴講者数：22名

いよいよPWBコンサルタント活動が始まる	榎場 正男 (株)カヤパオフィス/PWBコンサルタント
----------------------	-----------------------------

3) 電子回路基板ワークショップ

- 日 時：6月4日(木)、5日(金)
- 会 場：東6ホールI会場
- 聴講者数：139名(前回実績：685名)

6月4日(木)	
電子回路基板統合規格化に伴って用語を改訂! 電子回路(基板)用語(TD02)最新版紹介/ 次期部品内蔵基板パッケージデザインガイド紹介	友景 肇 福岡大学 浦西 泰弘 JPCA統合規格部会
電子回路基板三次元統合設計ツール最新動向	川瀬 英路 カミエンス・テクノロジー(株) 白鳥 高之 (株)ワイ・ディ・シー 松澤 浩彦 (株)図研
GE Packaging Technology Solutions For High Power Density Applications	Risto Tuominen GE Consultant
6月5日(金)	
電子回路基板統合規格化に伴って用語を改訂! 電子回路(基板)用語(TD02)最新版紹介/ 次期部品内蔵基板パッケージデザインガイド紹介	友景 肇 福岡大学 浦西 泰弘 JPCA統合規格部会
電子回路基板三次元統合設計ツール最新動向	川瀬 英路 カミエンス・テクノロジー(株) 白鳥 高之 (株)ワイ・ディ・シー 松澤 浩彦 (株)図研

4) 2015年度版プリント配線板技術ロードマップ

- 日 時：6月3日(水)~5日(金)
- 会 場：東6ホールK会場
- 聴講者数：506名(前回実績：65名)

6月3日(水)	
2015年度版プリント配線板技術ロードマップのご紹介	宇都宮 久修 インターコネクション・テクノロジーズ(株)
6月4日(木)	
2015年度版プリント配線板技術ロードマップのご紹介	雀部 俊樹 雀部技術事務所
6月5日(金)	
2015年度版プリント配線板技術ロードマップのご紹介	角井 和久 富士通(株)

5) 光電子回路実装標準化セミナー

- 日 時：6月3日(水)
- 会 場：東6ホールK会場
- 聴講者数：413名(前回実績：150名)

委員長挨拶	中野 義昭 東京大学
国際標準化の状況	伊藤 日出男 栃木県産業技術センター所長 IEC/TC91/JWG9 Convenor
光インタフェースの標準化活動	塩田 剛史 三井化学(株)
欧州の光回路実装プロジェクトの状況	林 武弘 (株)ハットラポ
シングルモード化が進む北米のデータセンタ状況	佐武 俊明 US Conec Ltd.



8 オープンセミナー

1) JPCA めっき表面処理セミナー

- 日 時：6月4日(木)、5日(金)
- 会 場：東2ホール F会場
- 聴講者数：247名(前回実績：712名)

6月4日(木)	
基板材料による無電解銅のカバーリング性の違い (委員会共同発表)	福士 浩二 (株)アズマ
湿式めっき法とエッチング法によるフィルム上への銅薄膜形成	布川 雅一 プラメックス(株)
極薄基板(40ミクロン以下)への銅めっき技術	中川 久也 (株)アズマ
6月5日(金)	
栄電子工業株式会社の総合力『微細配線への対応』	武藤 師裕 栄電子工業(株)
車載規格に対応するプリント配線板上無電解Ni/Auめっき	原田 修宏 田代電化工業(株)

2) JPCA 設計セミナー

- 日 時：6月4日(木)、5日(金)
- 会 場：東6ホール K会場
- 聴講者数：90名

6月4日(木)／6月5日(金)	
JPCAがサポートする高速信号設計	楠 和彦 (株)WADOW 社長

3) セキュリティ真贋認証セミナー

- 日 時：6月5日(金)
- 会 場：東6ホール K会場
- 聴講者数：28名

セキュリティ真贋認証、国際規格(ISO/TC247)の動向および 米国防授權法によるビジネスへのインパクト検証	伊賀 洋一 (一財)日本規格協会、東芝半導体サービス&サポート(株)
--	---------------------------------------

4) ぷりんとはんじゅくセミナー

- 日 時：6月3日(水)～5日(金)
- 会 場：東2ホール F会場
- 聴講者数：246名(前回実績：496名)

6月3日(水)	
【プリント配線板】 プリント配線板全般について“プリントばんじゅくⅠ”をもとに基礎から解決	小林 正 小林技術事務所
【プリント配線板設計】 プリント配線板設計について“プリントばんじゅくⅡ”をもとに基礎から解決	田中 弘文 (株)オンテック
【品質管理】 プリント配線板の品質保証のノウハウを、基礎から解説	長谷川 堅一 PWBコンサルタント
6月4日(木)	
【プリント配線板】 プリント配線板全般について“プリントばんじゅくⅠ”をもとに基礎から解決	小林 正 小林技術事務所
6月5日(金)	
【実装】 半導体のパッケージングから電子部品、メカ部品などの電子回路実装基板まで“プリントばんじゅくⅤ”をもとに平易に解説	榎場 正男 (株)カヤバオフィス/PWBコンサルタント



5) 半導体・オブ・ザ・イヤー2015 受賞製品・技術発表

- 日 時：6月3日(水) ●会 場：東4ホール G会場 ●聴講者数：65名(前回実績：65名)

電子デバイス産業新聞による、最先端のIT 機器・産業を支える半導体製品の表彰
受賞各社による製品プレゼンテーション

半導体・オブ・ザ・イヤー2015 受賞一覧

半導体デバイス部門		
グランプリ	ソニー(株)	積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS 第2世代品
優秀賞	日本サイプレス(株)	USB TypeCコントローラー「CCG1」「CCG2」
半導体製造装置部門		
グランプリ	株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ	立体構造を持つ電子デバイスに対応するレジスト塗布装置
優秀賞	東京エレクトロン(株)	次世代半導体向けスパッタリング装置「EXIM」
	ギガフォトン(株)	オープンプラットフォーム対応最新モデルArFレーザー「GT64A4」
半導体用電子材料部門		
グランプリ	エレメントシックス(株)	GaN on Diamond ウエハー 4インチ
優秀賞	デクセリアルズ(株)	最小パンプ間隔10μmの実装が可能なCOG実装向け粒子整列型異方性導電膜



6) WIRE Japan Show セミナー

- 日 時：6月4日(木)
- 会 場：東4ホール G会場
- 聴講者数：107名(前回実績：107名)

ノンハロゲンイントメッセント系難燃剤 FP-2200シリーズの紹介 大直子 (株) ADEKA
新難燃メカニズムによる PLA および PPE/PS の難燃化 山下 武彦 パナソニック(株) AVCネットワークス社
難燃材料の動向とその未来 大越 雅之 京都工芸繊維大学伝統みらい教育研究センター(富士ゼロックス(株))

7) NEDIA 電子デバイス展セミナー

- 日 時：6月4日(木)、5日(金)
- 会 場：東4ホール G会場
- 聴講者数：55名

6月4日(木)	
キャノントッキの最新スパッタリング装置とその技術 青沼 大介 キャノントッキ(株) 新商品開発部 商品開発第2課 課長	
六甲プレミアムプロセス ～ウエハの研削・研磨・洗浄工程の新しい取組み～ 伊藤 篤志 六甲電子(株) 営業部	
6月5日(金)	
電子デバイス製造工程用ウエハめっき装置/試作加工サービスのご紹介 鳥成 優一郎 (株)東設 技術営業部 課長	

8) 駐日大使館・自治体パビリオンセミナー

- 日 時：6月4日(木)、5日(金)
- 会 場：東4ホール G会場
- 聴講者数：44名

6月4日(木)	
兵庫県の企業誘致 岸野 孝彦 ひょうご・神戸投資サポートセンター 次長兼誘致課長	
神戸の投資環境及び進出支援制度 加藤 博望 神戸市 企画調整局 医療産業都市・企画誘致推進本部 企業立地課 企業誘致担当係長	
6月5日(金)	
電子デバイスの故障・欠陥解析事例の紹介 齋藤 英純 (公財)神奈川科学技術アカデミー 高度計測センター	
カナダの情報通信産業市場とイノベーション推進への取り組み オノヅカ アキコ カナダ大使館 商務部 二等書記官	

9) 「夢をカタチに」 次世代アプリ開発支援セミナー

- 日 時：6月3日(水)～5日(金)
- 会 場：東6ホール J会場
- 聴講者数：293名(前回実績：460名)

6月3日(水)	
基調講演/カーエレクトロニクス/ロボティクス	
基調講演 自動運転に必要な最新技術・製品 西村 明浩 (株)ZMP 取締役	
車載用ソリューション 斎藤 俊英 (株)ルネサス イーストン 第1営業本部 副部長	
DMM.comが目指すロボットキャリア販売プラットフォームとは? 岡本 康広 (株)DMM.com ロボット事業部 事業部長	
車載向け電子機器の設計動向 Willard Tu ARM Ltd. Director, Automotive Segment Marketing	
6月4日(木)	
特別講演/ウェアラブル	
特別講演 韓国のIoT政策とサムスンなど大手グループの戦略 巖 在漢 (株)産業タイムズ社 ソウル支局 支局長	
Telepathy Jumper(テレパシージャンパー) ～コミュニケーションとビジネスを変えるスマートグラスの可能性 鈴木 健一 (株)テレパシージャパン 代表取締役	
エアスカウターでビジネス支援を 篠田 章 ブラザー工業(株) E&I事業推進部 イノベーション企画G マネジャー	
進化する、ウェアラブル機器へ搭載可能な電源IC 前川 貴 トレックス・セミコンダクター(株) 事業本部 第二ビジネスユニット ビジネスユニット長	
6月5日(金)	
最新の設計・開発・製造ソリューション	
次世代の電子機器を実現する3D電子CAD CR-8000の可能性と発展性 松澤 浩彦 (株)図研 EDA事業部 EL開発部 シニア・パートナー	
次世代半導体のテストを支える超高多層、高精細プリント配線板の開発 小池 清 沖プリンテッドサーキット(株) 技術本部 開発部	
ボード設計者に身につけて頂きたいスキル ～セットメーカー様の要求に応えるために～ 長谷川 清久 (株)図研 EDA事業部 EL開発部 シニア・パートナー	
基板・デバイス上のフラックス除去に最適な洗浄と工程設計 八尋 大輔 ゼストロンジャパン(株)	
プリント回路業界の最新トレンド 野村 和広 (株)産業タイムズ社 電子デバイス産業新聞 副編集長	

9 イベント

1) 電子機器分解セミナー

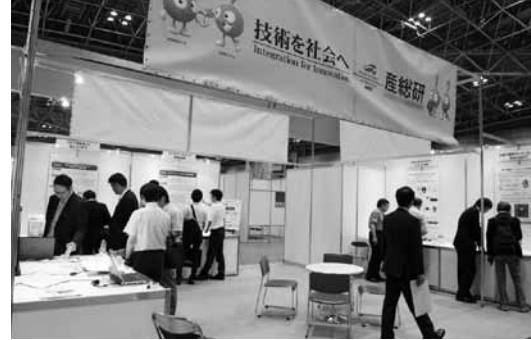
- 日 時：6月3日(水)～5日(金)
- 会 場：東6ホール 電子機器分解展示/セミナー会場
- 講 師：上田 弘孝 セミコンサルト
- 聴講者数：1,412名(前回実績：388名)

○Apple社iPhone 6/6Plusに見るスマホ実装技術
○おもちゃからスマホまであふれるセンサーの実装技術
○スマホカメラと車載カメラの技術動向とその要素技術
○先進運転支援システム(ADAS)のかなめ技術の概要
○TSMCの後工程参入の目玉FO-WLPのインパクト?

2) 産業技術総合研究所・特別展示

- 日 時：6月3日(水)～5日(金)
- 会 場：東6ホール6D-04

○様々な用途に対応する形状任意性センサー	フレキシブルエレクトロニクス研究センター
○「素材の味を引き出す」プロセスの開発	フレキシブルエレクトロニクス研究センター
○スクリーンオフセット印刷法による厚膜微細配線の形成	フレキシブルエレクトロニクス研究センター
○光電子集積サーバーボードの実現に向けて	電子光技術研究部門
○カーボンナノチューブ透明導電膜	電子光技術研究部門
○パルス光を用いた加工プロセス	電子光技術研究部門



3) 実装体験コーナ

- 日 時：6月3日(水)～5日(金)
- 会 場：東6ホール 実装体験コーナ **有料** 2,000円(税込) ●体験者数：19名(前回実績：98名)

教育プログラムの一環として毎回好評のロボットキットを使って楽しくはんだ付け部品実装を学び、体験できるコーナを設置。

6月3日(水)	6月4日(木)	6月5日(金)
	実装体験コーナ (ロボットキットを使った部品実装体験)	

4) IPC はんだ付けコンテスト日本大会

- 日 時：6月3日(水)～5日(金)
- 会 場：東6ホール IPC はんだ付けコンテスト会場

JPCA 姉妹団体米国IPCが主催するはんだ付けコンテスト。優勝者には2016年米国サンディエゴにて開催される世界大会への出場権が与えられた。



5) 2015 アカデミックプラザ受賞式

アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中から、JIEP 展示会事業委員会(小岩委員長：関東学院大学 工学部 物質生命科学科 教授)により優秀な論文内容が選考され、アカデミックプラザ賞受賞者が決定された。

●アカデミックプラザ受賞者

【AP-04】「第4級アンモニウム塩を含む非懸濁液からのZn-AlO_x(OH)_y複合電析」

関東学院大学 工学研究科 物質生命科学専攻 小岩研究室 一寸木 健太
工学総合研究所 渡辺 宣朗、理工学部小岩研究室 小岩 一郎、沖エンジニアリング株式会社 矢部 一博

【AP-25】「非晶質炭化珪素薄膜の室温形成法」

横浜国立大学大学院工学府 塩田 耕平、羽深 等

【AP-30】「BaTiO₃ ナノ粒子単分散インクを用いた薄膜コンデンサの開発」

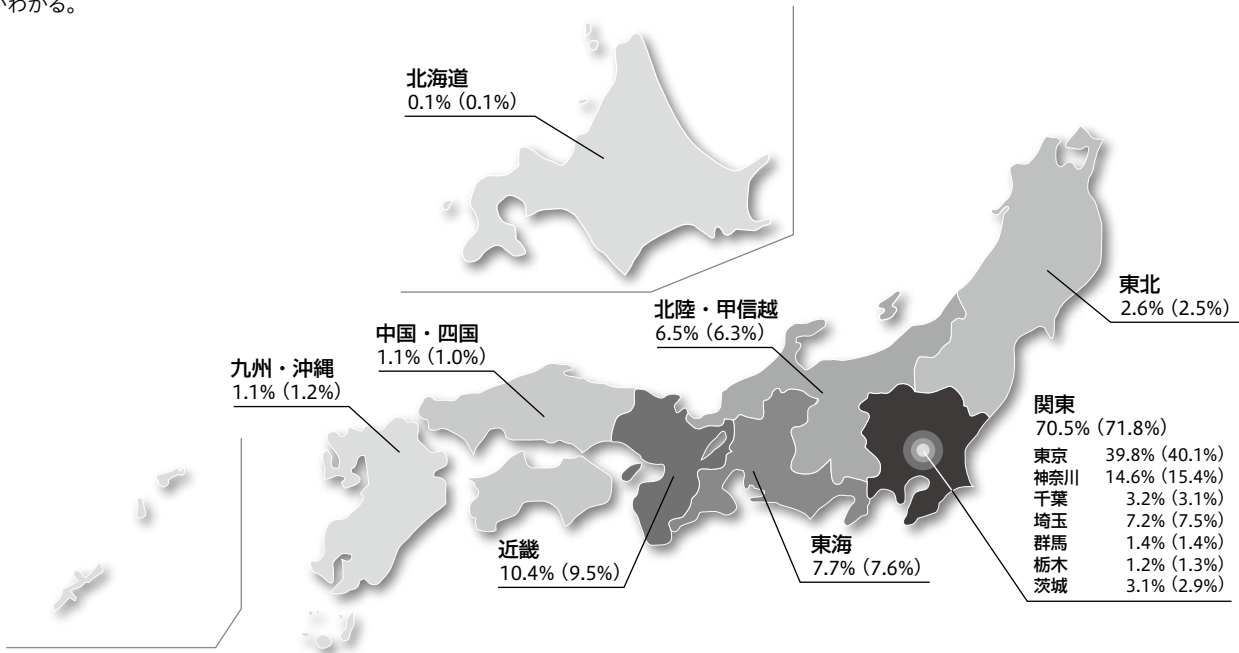
福岡県工業技術センター 化学繊維研究所 末松 昂一、有村 雅司、内山 直行、齋田 真吾、牧野 晃久

アカデミックプラザ5年連続継続賞

大阪府立大学	近藤研究室	東京大学	日暮研究室	龍谷大学	小川研究室
関東学院大学	小岩研究室	東京理科大学	越地研究室	信州大学	佐藤・曾根原研究室
九州大学	澤田研究室	同志社大学	生産システムデザイン研究室		

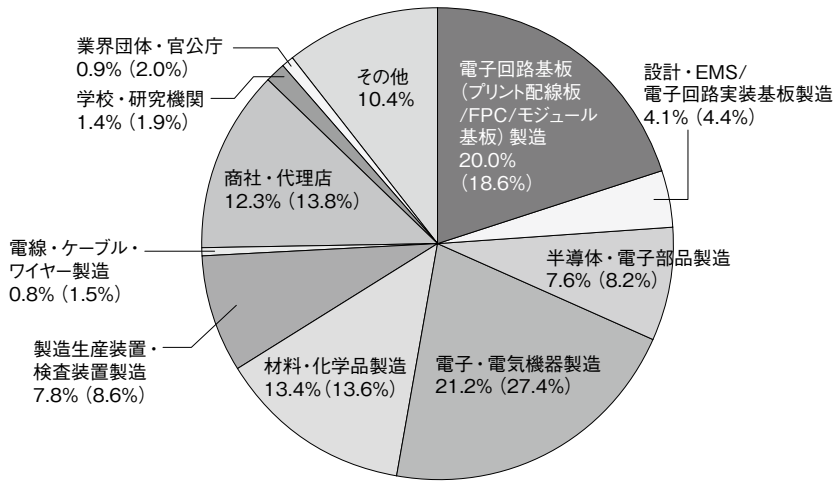
①国内来場者地域割合

東京都、神奈川県、埼玉県内からの来場者が多く、首都圏における自社PR、製品紹介、新規開拓、マーケティングを効果的に発信する絶好の機会であることがわかる。



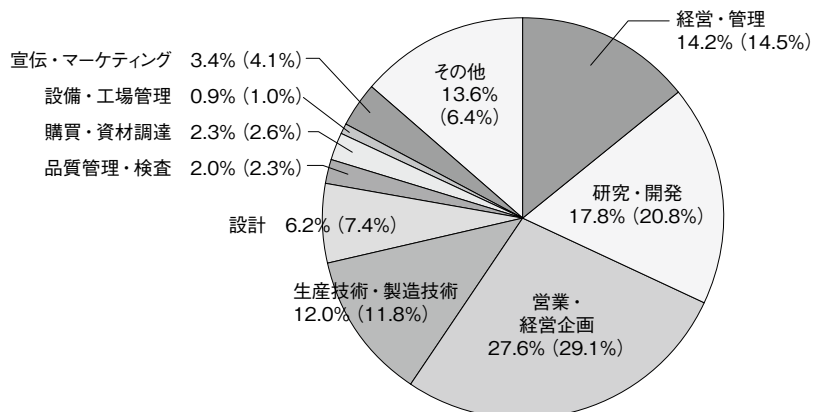
全展示会実績

②来場者の業種分類



エレクトロニクス総合展示会として異業種・他分野から影響力のある来場者を集客している。電子・電気機器製造分野では、特に自動車関連、情報通信関連分野から多くの技術者、購買関係者に来場頂いた。

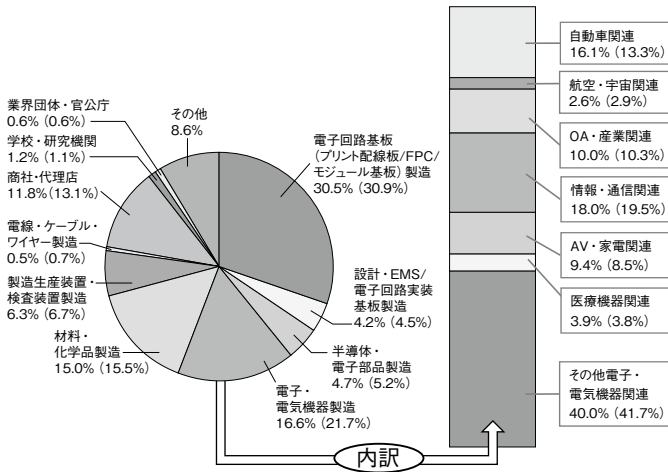
③来場者の職種分類



来場者の8割以上が購買関連分野、技術分野に関与しており、多方面にわたる目的意識をもった質の高い業界関係者との交流によるビジネスチャンスが期待できる。

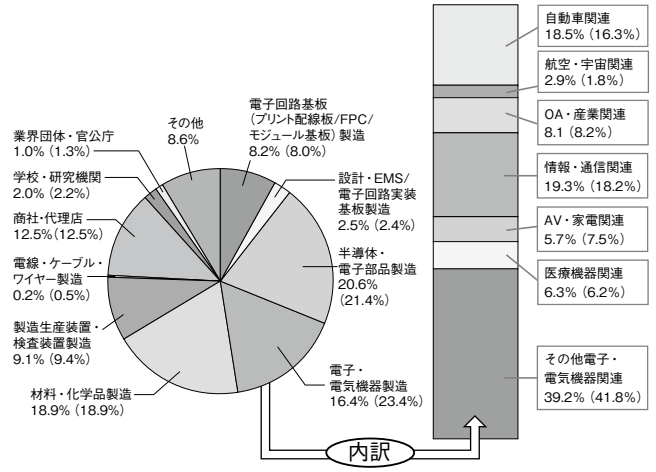
JPCA Show 2015

2015 プリント配線板技術展



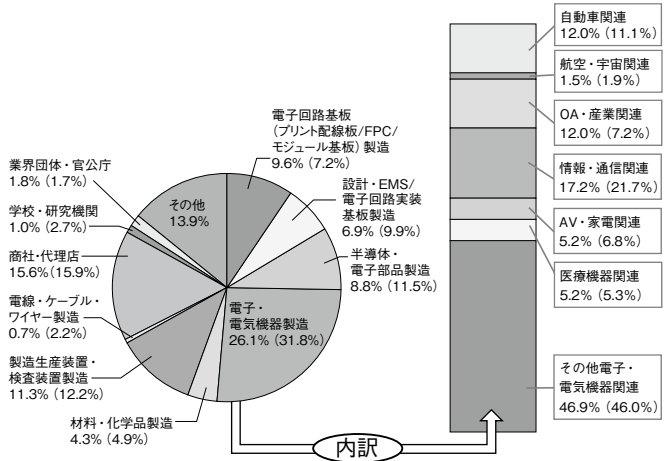
JPCA Show 2015

2015 半導体パッケージング・部品内蔵技術展



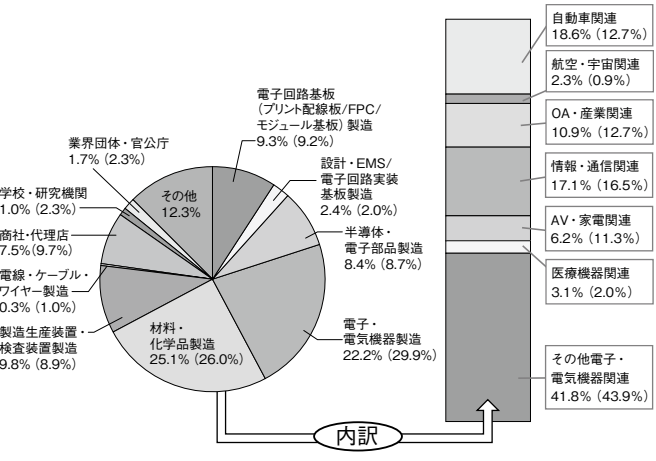
JPCA Show 2015

2015 機器半導体・受託生産システム展



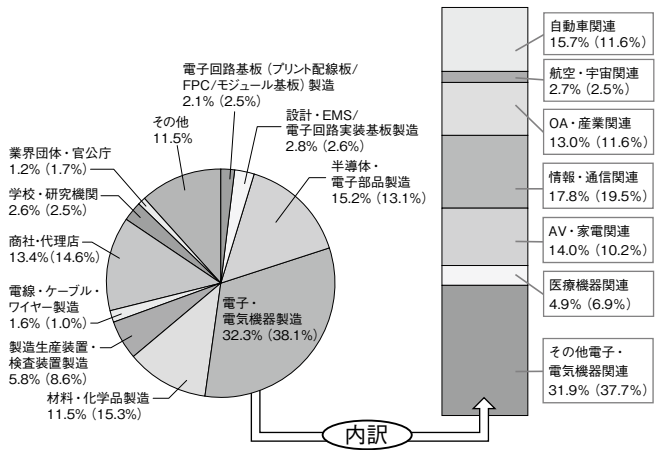
ラージエレクトロニクスショー-2015

2015 プリンテッドエレクトロニクス最適生産システム展



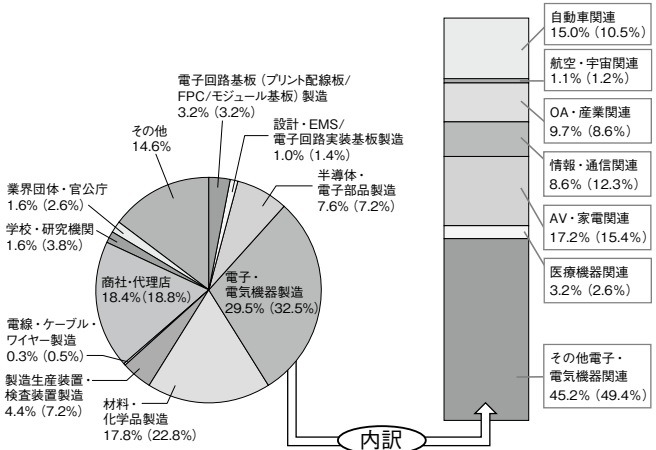
ラージエレクトロニクスショー-2015

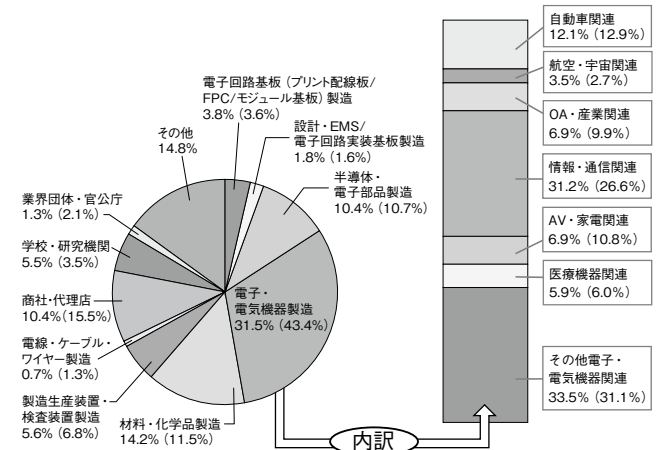
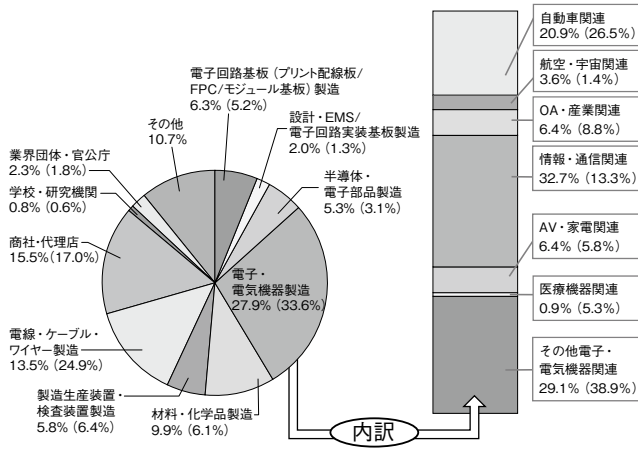
2015 部品・MEMS/デバイス産業総合資材材展



ラージエレクトロニクスショー-2015

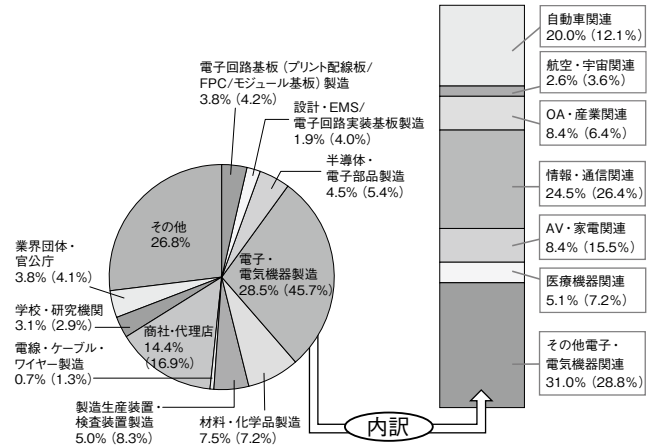
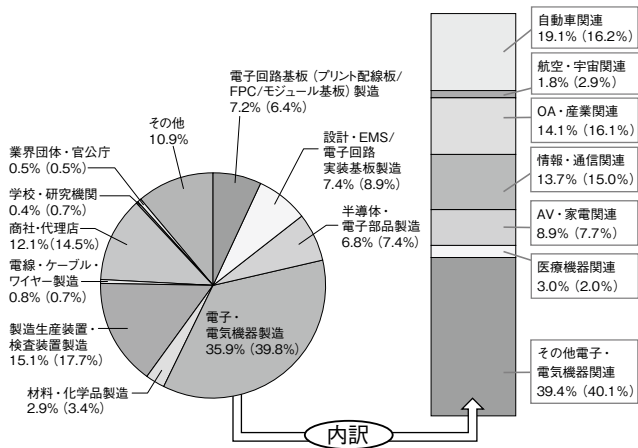
2015 LED/OLED 応用技術展





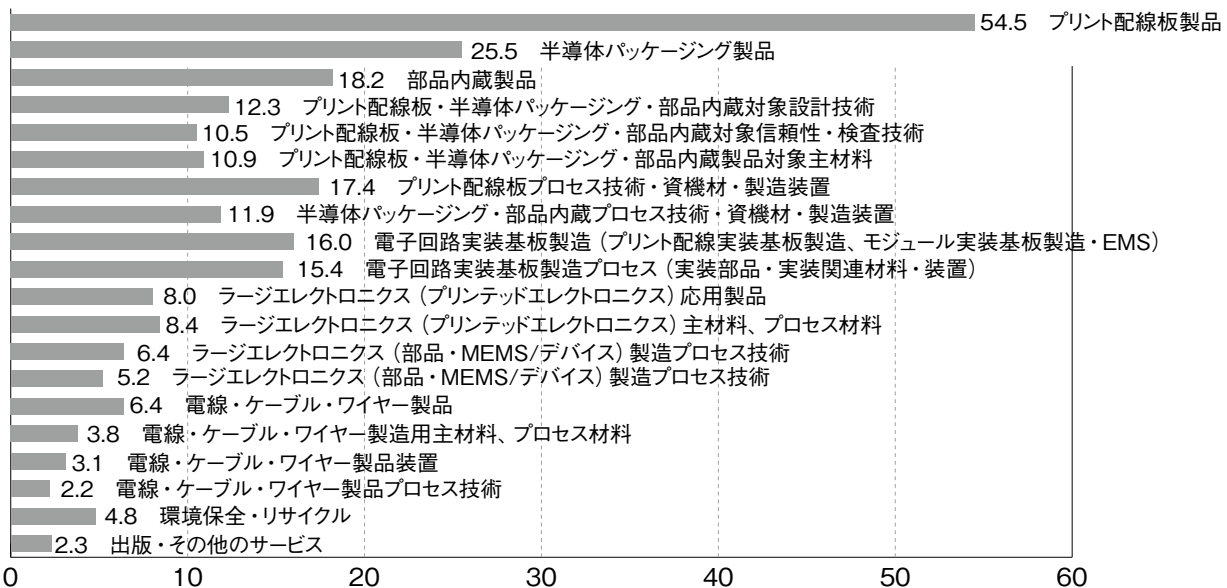
JISSO PROTEC 2015

ものづくりフェスタ2015

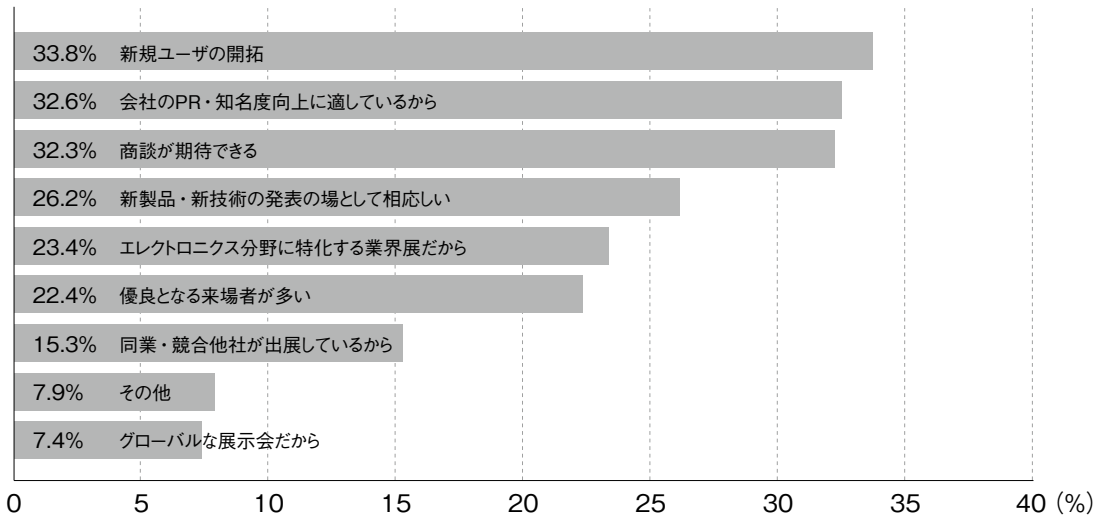


④来場者が関心のある製品分類

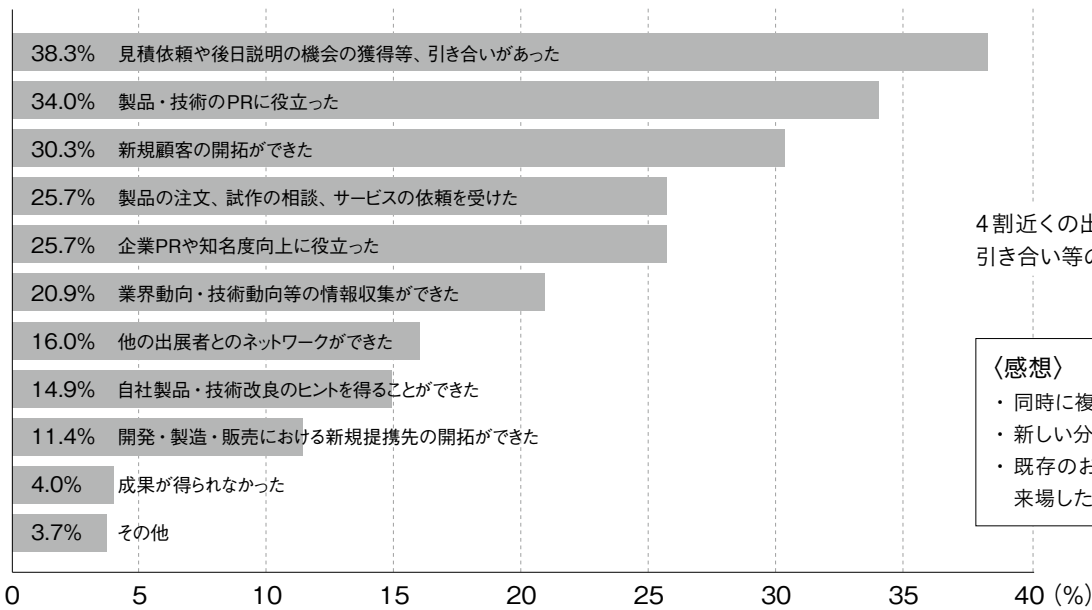
複数回答のため、指数 (ポイント) 表示



①出展目的 ※複数回答



②出展結果 ※複数回答

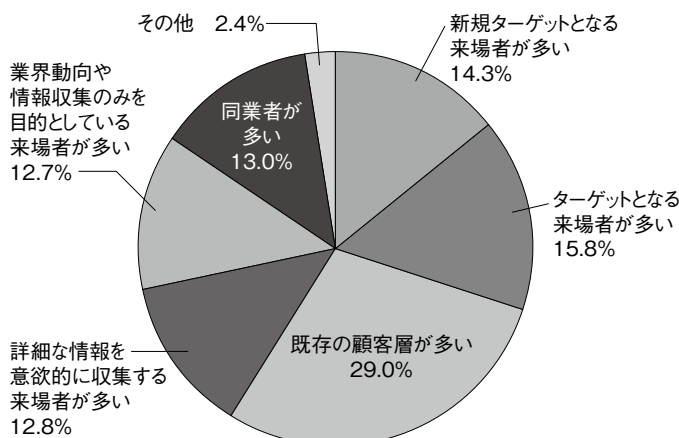


4割近くの出展者が新規顧客の獲得や引き合い等の成果を得ている。

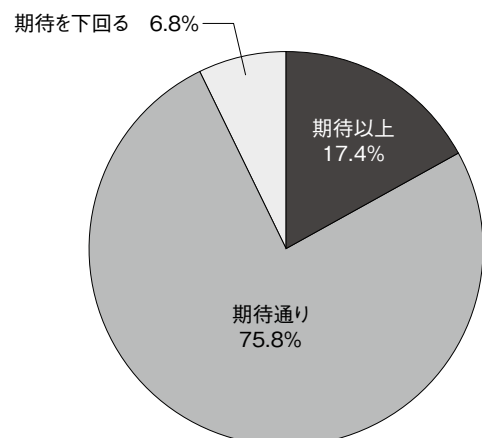
〈感想〉

- ・同時に複数案件の打合せができた。
- ・新しい分野の方と会えた。
- ・既存のお客様も数十名程ブースに会場した。

③来場者に対する評価

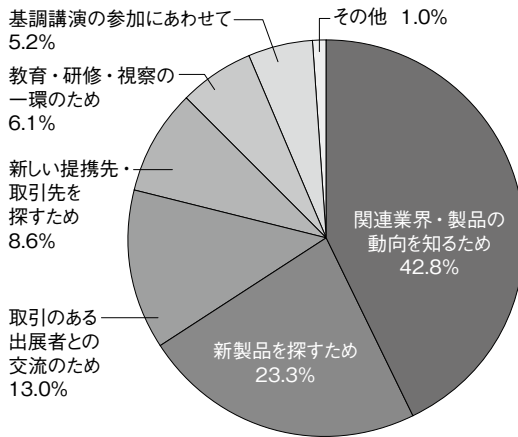


④展示会全体の印象



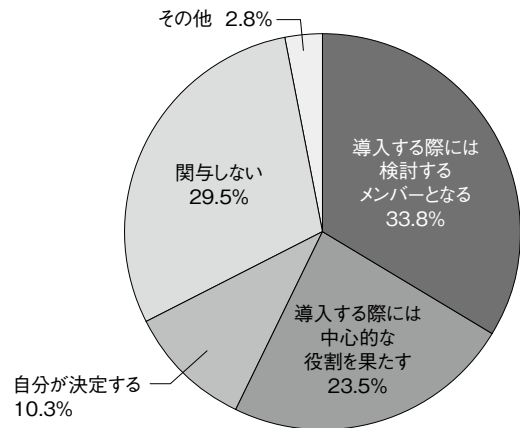
①来場の目的

7割以上の来場者がビジネスチャンスの拡大を期待している。



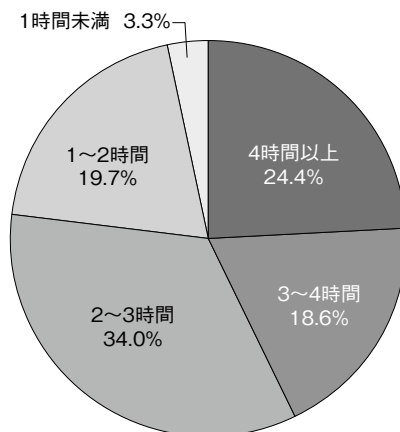
②製品仕込・購入への関与

7割以上が製品仕込・購入に関わるため、展示会での商談が期待できる。



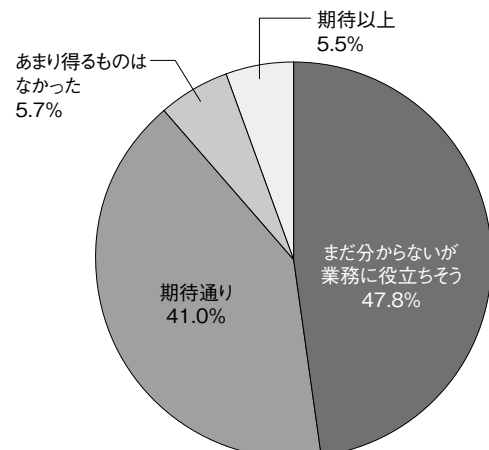
③滞在時間

半日以上の滞在が4割を超え、来場者の回遊率が高いことがわかる。

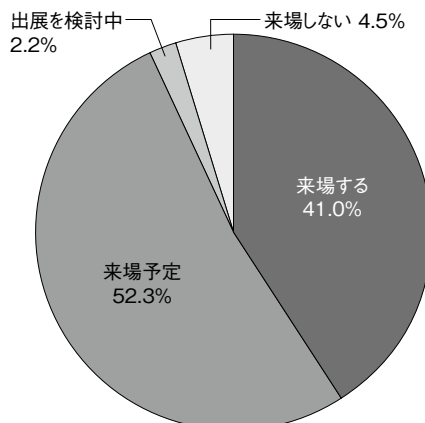


④展示会に対する満足度

9割以上の来場者にご満足頂いた。



⑤次回開催の来場予定



⑥ご意見・ご感想(一部抜粋)

〈出展者に対して〉

- ・展示企業の方針で難しいとは思いますが、新製品新技術を知りたい。
- ・基板加工などを実際に見られると嬉しい。
- ・できるだけ多くの実機展示。

〈主催者に対して〉

- ・より多くの商談、相談ルームの充実。
- ・規模も拡大し出展者を増やすことを期待。
- ・新製品情報、セミナー追加。

〈ご感想〉

- ・新情報/最先端の技術が入手できた。
- ・発想(新製品をつくるにあたっての)が面白いものがあった。
- ・新しいコストダウンの提案があった。
- ・基調講演が期待にあっており、特にウェアラブルの技術応用がわかった。
- ・新技術の情報入手は出来たが、目的の設備に関連するものが少なかった。

13 ビジネスマッチング

本年よりビジネスマッチングシステムを導入し、本年はトライアルとして出展者／来場者ともに無料で実施。
出展運営・商談実施の際のツールとして活用頂いた。

出展者および来場者ともに、展示会を通して登録者のニーズ×シーズを繋げるシステムです。



以下のような課題を解決します!

- ・製品/技術の導出
- ・製品/サービスの販売/提案
- ・共同研究/開発のための事業提携
- ・研究/開発のためのファイナンス、コンサルティング
- ・製品/技術の導入
- ・製品/サービスの購入/検討

- ・トライアル期間 5月～会期まで1ヶ月間実施
- ・マッチング件数 出展者お申込者68件、うち情報登録者36件
来場者お申込者32件、うち情報登録者13件
- ・アポイント成立件数 3件

<アポイント例>

PWB Tech×WIRE Japan
PWB Tech×EMS Japan
基板製造メーカー×行政団体等、
展示会・業種関係なしに
ニーズシーズを繋ぎ、
商談が成立しました!

14 出展者サービス

●記名印字済みバーコード付展者バッジ

本年は、記名印字済みのバーコード付展者バッジ・バーコード無しの従来型展者バッジの2種類を用意。
名刺交換の手間を省くバーコード付展者バッジは、多数の出展者にご利用頂いた。

●NPIプレゼンテーション

来場者に向けた自社製品・技術をPRする場として、展示会場ホール内にクロード会場をご用意した。プレゼンテーションに必要なPC、プロジェクタ、スクリーン等の備品も無料でご提供し、プロモーションの場として多数の出展者にご利用いただいた。



●多目的ルーム・ストックルーム

出展者の便宜を図るため、専用の多目的ルーム・ストックルームを有料にて貸し出した。専用ストックルームをブース近くに設置することにより、会期中、資材や荷物を安心して保管いただいた。

●ブースで利用可能なPOP印刷用データ

来場者が立ち寄りやすいよう、用途に応じて利用できる各種アイコンデータをご用意。
出展者が提供するシーズや提供内容を、来場者へわかりやすくPRした。

・機能別展示区分アイコン

> アプリケーションサイド設計担当者が直面する、解決したい課題に対応できる機能別に区分

・用途別アイコン

> 出展者の製品・技術を活用できる主な用途に区分

・ダントツ生産性向上PRアイコン

> 材料・設備・装置の出展者で、従来より生産性30%UPをアピール

・展示会各ブース多言語対応卓上POP

> 海外来場者向けに、出展者の対応可能言語を一目で確認

機能別対策区分表示



用途別アピール



ダントツ生産性 アピール



15 来場者サービス

●VIPラウンジ

「出展者の顧客招待活動の支援」、「来場者サービス向上の一環」、「決定権者の誘致」等を目的として実施された「VIPラウンジ」を展示会場内に3ヵ所設置。ソフトドリンクなどの飲料や、菓子類のサービスなどを行った。

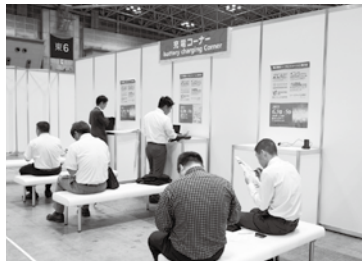


●WECC 訪日団来場者へのサービス

海外団体 (WECC : CPCA (中国印制電路行業協会)、HKPCA (香港線路板協会)、KPCA (韓国電子回路産業協会)、TPCA (台湾電路板協会)) が組織する訪日団来場者に対し、各団体事務局が適切なケアを行えるよう、団体専用事務局ルームを設置した。

●充電コーナー

会場内にて、ご自由にお使いいただける充電コーナーを設置。スマートホンやノートPCを充電しながら会場図を広げ、訪問したいブースを探す来場者の姿が多く見られた。



●インターネット・サービス

来場者への利便性を図るために、各ホール入口、VIPルーム、プレスルーム等会場内で「無料インターネット・サービス」を行った。



●電子回路サプライチェーンiCON展示

電子回路基板及び電子回路実装基板の企画から客先への納品までのビジネスフローに基づき、電子回路全体の製造サプライチェーンを图示し、サプライチェーン上に連なる出展者(希望者)の社名ロゴマーク及び小間番号を表示した日英表記巨大ボードをホール入口付近(ガレリア内)に設置した。



16 スポンサーシップ

昨年導入したスポンサーシップに、本年はプラチナスポンサーを加え、公募実施。約4万人の来場者へ広くアピール頂ける様々なスポンサー特典を用意し、ご活用頂いた。

プラチナスポンサー

日本メクトロン(株)/住友ベークライト(株)/eSurface Technology KK

ゴールドスポンサー

メック(株)/山下マテリアル(株)/ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株)/
(株)FPCコネクスト/日本オルボテック(株)

シルバースポンサー

(株)ニッセイ

(順不同)



<i>Platinum Sponsor</i>	
MekTEC www.mektron.co.jp	◆ 住友ベークライト株式会社
<i>Gold Sponsor</i>	
<i>Silver Sponsor</i>	
Nissei	

(1) プレスリリース配信／インタビュー記事掲載

●プレスリリース配信

- ① 10月 9日(木) 電子機器トータルソリューション展 出展募集開始
- ② 11月 6日(木) 早期申込締切日延長のお知らせ
- ③ 2月 6日(金) 最終申込締切日延長のお知らせ
- ④ 3月 5日(木) 最終申込締切再延長のお知らせ
- ⑤ 5月18日(月) 電子機器トータルソリューション展開催のお知らせ
第11回JPCA賞(アワード)受賞者決定
第7回JPCAデザインアワード受賞者決定
アカデミックプラザ賞/5年連続賞受賞者決定
- ⑥ 5月28日(木) 半導体・オブ・ザ・イヤー受賞者決定

●インタビュー記事掲載

- ① 1月22日(木) 電子デバイス産業新聞に展示会運営委員長のインタビュー記事掲載
- ② 3月 9日(月) 電線新聞に展示会運営委員長のインタビュー記事掲載
- ③ 5月21日(木) 電子デバイス産業新聞に展示会運営委員長のインタビュー記事掲載
- ④ 6月 3日(水) 日経産業新聞に展示会運営委員長のインタビュー記事掲載



●電子デバイス産業新聞 掲載日：1月22日



●電線新聞 掲載日：3月9日



●日経産業新聞 掲載日：6月3日

(2) グローバル／海外展示会出展実績

6か国の展示会に出展し、PR活動を実施した。

- ・2014年 8月 6日(水)～8日(金) インド：IPCA-EFY Expo
- ・2014年10月22日(水)～24日(金) 台湾：TPCA Show
- ・2014年12月 3日(水)～5日(金) 香港：HKPCA & IPC Show
- ・2015年 2月24日(火)～26日(木) 米国：IPC APEX EXPO
- ・2015年 3月17日(水)～19日(金) 中国：CPCA Show
- ・2015年 4月22日(水)～24日(金) 韓国：KPCA Show

(3) 展示会公式サイト

年間を通じて様々な情報をリアルタイムに配信した。公式サイトでは、出展者情報を始め、各種情報を集約した他、来場者事前登録、基調講演／特別講演／パネルディスカッション・JIEP最先端実装技術シンポジウム・国際セミナーのセミナー聴講登録も実施した。本年は、ビジネスマッチング登録も開始し、出展者・来場者向けの情報発信を効果的に行った。

●閲覧者数(ページビュー)

54,556PV(4月～会期までの約2ヶ月間)

※ページビューとは、ウェブサイトがどのくらい閲覧されているかを測るための指数のことをいう。

●来場者事前登録者数

11,160名(4月下旬～会期までの約1ヵ月間)



(4) オフィシャルメールマガジン

過去の来場者および産業タイムズ社データベース、日経BP社データベース、約15万件を対象に配信。

(5) PRツール製作及び配付

- 国内用招待状275,000部、海外用招待状40,000部、VIP招待券45,000部、ポスター2種1,600枚(各800枚)を作成し、出展者・主催/共催団体・協賛団体、過去来場者を中心に配布した。
- 公式ガイドブック「EXPO NAVI」「フロアマップ(和英)」を作成し、会期中を通じ、全来場者・出展者に向けて配布した。



ポスター

(6) 広告掲載媒体

電子機器トータルソリューションの見どころやセミナー情報等、15広告媒体に掲載された。

JPCA NEWS/エレクトロニクス実装技術/JARA機関紙/電子デバイス産業新聞/電線新聞/日経産業新聞/化学工業日報/インコム/DMカード/電波新聞/日刊工業新聞/日エフォーラム/メカトロニクス/プリント回路ジャーナル/日本鍍金新報

2015展示会運営委員会

委員長	山本 治彦 (JPCA 副会長 / 超高効率電子回路生産システム研究会)
副委員長	曾谷 太 (JPCA 理事 / ソマール(株))
	四津 三樹男 (ピアメカニクス(株))
委員	須賀 唯知 (JIEP 会長 / 東京大学)
	土門 孝彰 (JIEP 展示会事業委員会委員長 / TDK(株))
	永嶋 弘和 (JISSO PROTEC 2015 運営委員長 / JUKI(株))
	泉谷 渉 (ラージエレクトロニクスショー 共催会社代表 / 株産業タイムズ社)
	井上 政基 (WIRE Japan Show 共催会社代表 / 株工業通信)

展示会企画委員会

委員長	山本 治彦 (JPCA 副会長)
委員	青山 雅之 (株デンソー)
	泉谷 渉 (株産業タイムズ社)
	上田 裕司 (JUKIオートメーションシステムズ(株))
	内田 幸一 (日本オルボテック(株))
	岡 謙吾 (株工業通信)
	兼子 昌和 (日本メクトロン(株))
	熊谷 立人 (ヤマハ発動機(株))
	小岩 一郎 (関東学院大学)
	後藤 哲朗 (株ニコン)
	須賀 唯知 (東京大学)
	土門 孝彰 (TDK(株))
	松本 博文 (日本メクトロン(株))

JPCA 活性化委員会

委員長	岩城 慶太郎 (メルテックス(株))
副委員長	兼子 昌和 (日本メクトロン(株))
委員	高見澤 栄治 (ソマール(株))

JIEP 展示会事業委員会

委員長	土門 孝彰 (TDK(株))
副委員長	高野 希 (日立化成(株))

最先端実装技術シンポジウム WG

委員長	小日向 茂 (大阪大学)
委員	齊藤 雅之 (株東芝)
	西田 秀行 (ニシダエレクトロニクス実装技術支援)
	宝蔵寺 裕之 (株日立製作所)
	金子 俊之 (京セラサーキットソリューションズ(株))
	松原 孝宏 (京セラ(株))
	内海 裕一 (兵庫県立大学)
	猪川 幸司 (日本シイエムケイ(株))
	本多 進 (C-NET)
	和嶋 元世 (C-NET)
	田畑 晴夫 (大阪大学)
	三宅 敏広 (株デンソー)
	西村 芳孝 (富士電機(株))
	伊藤 寿浩 (東京大学)
	八甫谷 明彦 (株東芝)
	加藤 康男 (青山学院大学)
	平田 勝子 (JIEP 事務局)

アカデミックプラザ WG

委員長	小岩 一郎 (関東学院大学)
副委員長	白石 洋一 (群馬大学)
委員	澤田 廉士 (九州大学)
	内木場 文男 (日本大学)
	荘司 郁夫 (群馬大学)

JISSO PROTEC 2015 運営委員会

委員長	永嶋 弘和 JUKI(株)
副委員長	富士原 寛 (一社)日本ロボット工業会
委員	青田 広幸 パナソニック ファクトリーソリューションズ(株)
	曾我 信之 富士機械製造(株)
	太田 裕之 ヤマハ発動機(株)

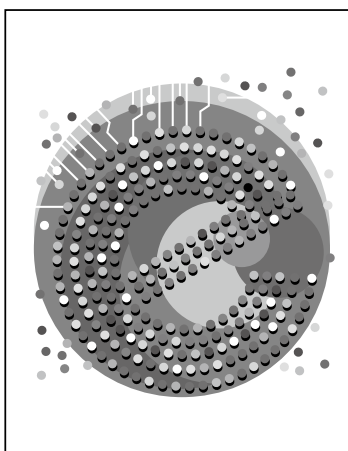
JISSO PROTEC 2015 実行委員会

委員長	上田 裕司 JUKIオートメーションシステムズ(株)
副委員長	熊谷 立人 ヤマハ発動機(株)
委員	西村 勤 パナソニック ファクトリーソリューションズ(株)
	今井 美津男 富士機械製造(株)
	角屋敷 敏丸 千住金属工業(株)
	榊 寿光 マイクロニックテクノロジーズ(株)
	矢内 重章 (一社)日本ロボット工業会

JISSO PROTEC 2015 企画部会

部会長	上田 裕司 JUKIオートメーションシステムズ(株)
副部会長	熊谷 立人 ヤマハ発動機(株)
委員	西村 勤 パナソニック ファクトリーソリューションズ(株)
	今井 美津男 富士機械製造(株)

(順不同・敬称略)



次回開催のご案内

JPCA Show 2016 ラージエレクトロニクスショー2016
WIRE Japan Show 2016 2016マイクロエレクトロニクスショー
JISSO PROTEC 2016 ものづくりフェスタ2016

2016.6.1 (Wed.) -3 (Fri.)
東京ビッグサイト 東2-6ホール

詳細は展示会ウェブサイトへ▶ <http://www.jpca-show.com/>

▶ お問い合わせ先

展示会運営事務局：株式会社ICSコンベンションデザイン

TEL: 03-3219-3561 FAX: 03-3219-3628 E-mail: jpca-show@ics-inc.co.jp

JPCA 2015
Show
第45回国際電子回路産業展
45th International Electronic Circuits Exhibition
主催：一般社団法人日本電子回路工業会
Sponsored by JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association



ラージエレクトロニクスショー2015
共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電子デバイス産業新聞(産電タイムズ社)
Co-Sponsored by:
JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association
Electronic Device Industry News (Sanyo Times, Inc.)
Large Electronics Show 2015

W **WIRE Japan Show**
2015
電線・ケーブル・コネクタ総合技術展
共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電線新聞(1社)工業通信

JIEP 2015
マイクロエレクトロニクスショー
第29回 最先端実装技術・パッケージング展
29th ADVANCED ELECTRONICS PACKAGING EXHIBITION
主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP)
Sponsored by JIEP-Japan Institute of Electronics Packaging

JISSO
PROTEC 2015
第17回 実装プロセステクノロジー展
17th Jisso Process Technology Exhibition
主催：一般社団法人日本ロボット工業会
Sponsored by JIRA-Japan Robot Association (JARA)

JPCA

一般社団法人日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2F

TEL (03) 5310-2020 FAX (03) 5310-2021

<http://jpca.jp>